

**北京海润天睿律师事务所**  
关于和舰芯片制造（苏州）股份有限公司  
首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（二）

[2019]海字第 017-2 号

中国·北京

**北京海润天睿律师事务所**  
关于和舰芯片制造（苏州）股份有限公司  
首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书

[2019]海字第 017-2 号

**致：和舰芯片制造（苏州）股份有限公司**

根据发行人与本所签订的《法律服务协议》，本所接受发行人的委托，担任发行人本次发行上市的特聘专项法律顾问。本所律师根据《公司法》、《证券法》、《科创板首发管理办法》、《科创板上市规则》、《若干意见》、《通知》、《律师证券业务管理办法》、《编报规则 12 号》、《律师执业规则》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的其他有关规定，以及本所与发行人签订的《法律服务协议》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具了[2019]海字第 017 号《北京海润天睿律师事务所关于和舰芯片制造（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》、[2019]海字第 018 号《北京海润天睿律师事务所关于和舰芯片制造（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的律师工作报告》。

本所现根据上海证券交易所上证科审（审核）（2019）131 号《关于和舰芯片制造（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称《问询函》）并股份公司实际情况，就股份公司本次发行上市过程中涉及的事项，出具本补充法律意见书。本补充法律意见书所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明外，与发行人本次发行上市的招股说明书含义相同。

**一、《问询函》1. 关于同业竞争**

**发行人与其控股股东联华电子从事完全相同业务。联华电子及其控制的其他企业市场区域为台湾、日本、韩国、北美洲、新加坡、欧洲市场，发行人除大陆市场外，还涵盖联华电子市场区域之外所有区域，双方进入对方市场均需要支付代理费或服务费。**

请发行人：（1）结合报告期内发行人与最终控股股东及其关联方在相关产品产能、产量、产销量、毛利率等方面及其变化情况，客户、供应商重叠的具体情况，进一步说明在核心制程工艺受制于控股股东，相关代理费或服务费金额相对销售收入金额占比很小的情形下，通过市场区域划分方式解决同业竞争的措施是否切实可行、有效，是否会对发行人自主拓展市场、持续经营产生重大不利影响；（2）在竞争方的同类收入或毛利占发行人该类业务收入或毛利的比例达 30% 以上的情况下，认定对发行人不构成重大不利影响的依据是否充分，补充提供相关证据，并结合证据论证发行人是否符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法》（试行）规定的发行条件；（3）说明美国联电收取的代理费与日本联电收取的代理费差异较大的原因及合理性，定价依据及其公允性。

请发行人披露以地域、细分产品划分解决同业竞争问题的做法是否符合相关监管要求。请进一步提出解决同业竞争的切实可行的方案，避免给发行人带来重大不利影响。

请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查，并发表明确意见。

回复：

1、结合报告期内发行人与最终控股股东及其关联方在相关产品产能、产量、产销量、毛利率等方面及其变化情况，客户、供应商重叠的具体情况，进一步说明在核心制程工艺受制于控股股东，相关代理费或服务费金额相对销售收入金额占比很小的情形下，通过市场区域划分方式解决同业竞争的措施是否切实可行、有效，是否会对发行人自主拓展市场、持续经营产生重大不利影响；

（1）报告期内发行人与最终控股股东及其关联方在相关产品产能、产量、产销量、毛利率等方面及其变化情况

①报告期内，发行人主要产品的产能、产量、销量、毛利率如下：

项目	2018 年	2017 年	2016 年
一、8 英寸			
产能（片/年）	770,828	753,374	749,575
产量（片）	856,934	824,833	679,944
销量（片）	850,707	823,022	683,092
毛利率	32.16%	33.45%	27.67%
二、12 英寸			
产能（片/年）	183,334	97,028	6,000
产量（片）	103,472	76,257	5,607
销量（片）	101,879	74,189	5,515

毛利率	-156.96%	-125.28%	-170.20%
-----	----------	----------	----------

报告期内，发行人 8 英寸的产能变化不大，产量、销量均有所增长，主要系市场景气度的提升和新客户的开发对 8 英寸产品需求增加所致，毛利率 2017 年和 2018 年保持稳定，2016 年毛利率略低主要是因为产能利用率低所致；发行人 12 英寸生产线于 2016 年 11 月建成投产，随着产能的释放，报告期内发行人 12 英寸的产能、产量、销量均快速增长，由于非流动资产折旧和摊销金额太大，导致发行人 12 英寸产品毛利率为负。

②报告期内，联华电子主要产品的产能、产量、销量、毛利率如下：

项目	2018 年	2017 年	2016 年
一、8 英寸			
产能（片/年）	2,844,470	2,816,037	2,748,389
产量（片）	2,893,131	2,840,221	2,566,705
销量（片）	2,874,161	2,825,322	2,553,641
毛利率	38.00%	37.30%	34.6%
二、12 英寸			
产能（片/年）	3,422,275	3,279,702	3,226,812
产量（片）	3,014,280	2,888,599	2,762,732
销量（片）	3,009,617	2,851,573	2,757,143
毛利率	18.8%	20.9%	15.0%

注：联华电子产能、产量等数据不含和舰芯片及厦门联芯数据。

报告期内，联华电子的 8 英寸产能变化不大，产量、销量增加的主要原因是市场景气度的提升客户对 8 英寸产品需求增加所致；毛利率 2017 年和 2018 年变化不大，2016 年毛利率较低是因为产能利用率较低所致；报告期内，联华电子 12 英寸产能变化不大，产量、销量增加主要系客户对 12 英寸产品需求增加所致，12 英寸毛利率变动较小。

综上所述，报告期内发行人与联华电子的 8 英寸产能变化幅度不大，产量和销量变化趋势一致，联华电子 8 英寸产品毛利率高于发行人的原因主要系折旧摊销差异所致，扣除折旧摊销的差异后，毛利率差异不大；报告期内联华电子 12 英寸产能、产量、销量、毛利率变动幅度不大，发行人因厦门联芯产能的释放，12 英寸产能、产量和销量增长明显，因折旧摊销较大导致厦门联芯 12 英寸产品毛利率为负。报告期内，发行人的产能、产量、销量不断增加，而联华电子的产能、产量、销量保持稳定，因此市场区域的划分，有利于增强发行人自主拓展市场的能力，对发行人的持续盈利能力不构成重大不利影响。

(2) 发行人与最终控股股东及其关联方客户、供应商重叠的具体情况

报告期内，发行人与最终控股股东及其关联方的客户、供应商存在重合，具体情况如下：

项 目	2018 年	2017 年	2016 年	
客户重叠情况	发行人	95.76%	94.21%	93.86%
	联华电子	57.25%	56.94%	55.41%
供应商重叠情况	发行人	25.59%	27.86%	33.54%
	联华电子	27.78%	31.45%	35.67%

报告期内，发行人与联华电子的供应商重合度较低，并且比例逐年下降。双方存在重合供应商主要是由于晶圆代工所需原材料尤其是硅片主要由全球几家厂商如 SUMCO、环球晶圆等提供，发行人与联华电子均需从上述供应商采购硅片。

报告期内发行人与联华电子的客户重合度较高，但市场区域划分对于发行人自主开拓客户、持续经营发展不存在重大不利影响，具体理由如下：

A、发行人与联华电子客户高度重合主要由于晶圆代工行业的客户为芯片设计公司，根据 IC Insights 统计，2018 年全球前十大 IC 设计厂商的销售额占比 70% 以上，由于 IC 设计销售的高度集中从而导致晶圆代工厂的销售也较为集中，晶圆代工厂的主要客户为排名靠前的 IC 设计厂商。发行人与联华电子客户的重合度高是由于晶圆代工行业的特性决定的。

B、发行人与联华电子客户存在重合度高的情况，但双方重合客户的所购买晶圆产品在层数、制程工艺、应用领域等方面存在差异，双方重合客户购买的产品并不一致。发行人与联华电子为重合客户提供的是定制化、差异化的产品和服务。市场区域的划分对发行人现有的客户没有影响，对发行人持续经营不构成影响。

C、发行人拥有完整独立的销售服务体系，销售人员独立于控股股东。发行人能够独立按照市场竞争地位开发客户，争取订单，除了美国、日本外，发行人与中国大陆、台湾地区、新加坡、韩国、欧洲的客户均独立直接的签署销售合同。虽然存在市场区域划分，发行人仍然可以开拓中国大陆、台湾地区、新加坡、韩国、欧洲客户。

D、发行人客户主要是芯片设计公司，这些客户在不同的集成电路制造企业之间转换时间周期及成本较高，因此一旦产品通过某一个晶圆制造企业生产线验证后，在良率和交期等要素良好的情况下，一般不会轻易更换供应商，只会根据自身需求情况变化采购量。因此市场区域划分不会导致发行人客户流失，不会影响发行人的持续经营。

综上所述，发行人、联华电子存在客户、供应商重合的情形，上述客户、供应商重合是由芯片制造行业特点所决定，发行人、联华电子对重合客户、供应商各自独立签订销售、采购合同，定价公允。发行人、联华电子不存在通过重合客

户、供应商进行利益输送的情形，市场区域的划分不会影响发行人自主开拓客户的能力，对发行人持续经营发展不存在重大不利影响。

(3) 进一步说明在核心制程工艺受制于控股股东

发行人的核心制程工艺包括自主技术和授权技术。发行人的自主技术包括 0.11 μm 嵌入式 pFlash 低功耗工艺、0.11 μm 嵌入式 pFlash 超低功耗工艺、0.11 μm 嵌入式 EEPROM 低功耗工艺、0.15 μm、0.18 μm、0.25 μm、0.35 μm、0.5 μm 制程及相应工艺等。

发行人来自于联华电子的授权技术包括 0.11 μm 逻辑、0.11 μm 混合信号工艺、0.11 μm 至 0.13 μm eFlash 和 0.11 μm BCD 工艺、28nm、40/55nm、80/90nm 制程技术，其中 0.11 μm 至 0.13 μm eFlash 和 0.11 μm BCD 工艺发行人在实际生产中并没有使用。

报告期内发行人自主技术和授权技术所产生的收入及毛利情况如下：

单位：万元

项目	2018 年		2017 年		2016 年	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
自主技术	219,362.55	62.02%	207,561.46	64.62%	171,839.64	93.68%
授权技术	134,328.06	37.98%	113,635.37	35.38%	11,592.17	6.32%
合计	353,690.61	100%	321,196.83	100%	183,431.81	100%
项目	2018 年		2017 年		2016 年	
	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比
自主技术	69,680.45	-	69,028.09	-	47,067.36	-
授权技术	-204,736.71	-	-136,229.42	-	-12,278.38	-
合计	-135,056.27	-	-67,201.33	-	34,788.98	-

报告期内，公司自主技术带来的收入占比超过 60%，报告期公司毛利全部来自自主技术，授权技术对公司毛利贡献为负。

报告期公司授权技术带来的收入占比增加主要是因为公司 12 英寸生产线 2016 年底刚刚建成投产，为了快速提高我国芯片制造技术水平和降低研发风险，发行人通过控股股东取得 12 英寸相关技术授权并在此基础上进行客制化、差异化研发形成 12 英寸相关核心技术体系，12 英寸相关技术主要来自控股股东授权，发行人控股股东授权的技术是完整技术，发行人通过在引进吸收的基础上进行客制化和特色工艺研发，已完全掌握控股股东授权的先进制程技术，并且完全有能力进行特色工艺的研发，完全可以满足生产经营的需要，对控股股东技术不存在重大依赖。综合报告期授权技术对发行人收入和毛利的贡献，公司生产经营对授权技术不存重大依赖，发行人的核心制程工艺并未受制于控股股东。

综上所述，发行人生产经营对授权技术不存重大依赖，发行人的核心制程工

艺并未受制于控股股东，对发行人的持续经营不存在重大不利影响。

(4) 相关代理费或服务费金额相对销售收入金额占比很小的情形

发行人在美国、日本通过美国联电、日本联电进行经销，美国联电、日本联电获取销售差价。为防止将发行人的经销模式误解为代销，因此将之前表述的“代理费”改为销售差价。

①相关销售差价或服务费自 2015 年起即在严格执行

2013 年 2 月联华电子取得了发行人的控制权，2013 年 2 月至 2014 年联华电子与发行人处于重整评估阶段，并聘请安永（中国）企业咨询有限公司出具了《关于：和舰科技（苏州）有限公司转让定价分析备忘录》，对发行人和联华电子之间关联交易定价原则进行了约定。

针对发行人与联华电子各自进入对方市场区域事项，2015 年起发行人与联华电子签署了《销售服务合约》，约定联华电子在台湾、新加坡地区为发行人提供晶圆代工业务营销支持服务，发行人在大陆地区为联华电子提供晶圆代工业务营销支持服务。双方提供的服务包括：市场商情收集；协助客户的接洽联系；其他相关事项。发行人与客户仍直接签署销售合同。

自 2015 年起，发行人在美国、日本通过美国联电、日本联电进行经销，美国联电、日本联电获取销售差价。

从 2015 年至目前，发行人与联华电子、美国联电、日本联电均严格按照《销售服务合约》和相关销售订单的约定执行，并未因本次发行上市而进行调整。

②双方支付的服务费或代理费确定依据，定价具有合理性，价格公允

发行人向联华电子支付的服务费=联华电子所提供服务的总成本\*（1+7.5%）\*（1+5%），实际发生总成本为相关人事费用如薪资、奖金、加班费等，5%为台湾地区的营业税；联华电子向发行人支付的服务费=发行人所提供服务的总成本\*（1+7.5%）\*（1+6%），其中 6%为中国大陆增值税税率。实际发生总成本为相关人事费用如薪资、奖金、加班费、公积金等。上述定价具有合理性，价格公允。

发行人在美国、日本通过美国联电、日本联电进行经销，美国联电、日本联电获取销售差价，其中美国联电获取的销售差价为其对外销售价格的 1%，日本联电获取的销售差价为其对外销售价格的 2%-5%。美国联电、日本联电获取的销售差价需要根据美国、日本税务机关确认或者认可的销售利润率并依据两个公司具体销售、运营成本情况进行调整。上述定价具有商业合理性，价格公允。

综上所述，自 2015 年起发行人与联华电子及其关联方划分了市场区域，针对跨区域销售情况，互相支付服务费或者给予销售差价，虽然相关销售差价或服务费金额相对销售收入金额占比很小，但是相关销售差价、服务费的定价合理，价格公允，并未因发行人本次发行上市而进行调整，保证了发行人与联华电子及其

关联方各自独立的市场地位，是通过划分市场区域解决同业竞争的有效辅助手段。

(5) 通过市场区域划分方式解决同业竞争的措施是否切实可行、有效

① 市场区域划分的原因、合理性，并且市场区域划分切实可行

A、发行人及子公司厦门联芯分别成立于 2001 年、2014 年，自成立之日起，发行人与子公司厦门联芯即立足于大陆市场区域，积极开拓大陆市场客户，经过多年的发展，发行人在大陆地区积累了良好的声誉和较大的客户群，并建立了完整的销售体系，发行人已在中国大陆确定了稳固的市场地位。此外，近年来集成电路在中国的快速发展使得发行人具有充足的市场空间，根据《国家集成电路产业发展推进纲要》，到 2020 年我国集成电路全行业销售收入年增速超过 20%，根据中国半导体协会预计，2020 年我国集成电路产业销售规模预估达到 9,825.4 亿元，市场前景广阔。因此将中国大陆地区以及联华电子及其控制的其他企业市场区域外的全球其他国家或地区划为发行人的市场区域具有合理性，并且切实可行。

B、联华电子成立于 1980 年，联华电子在美国的子公司美国联电成立于 1997 年，上述两个公司的成立时间均早于发行人，并在台湾、美国经营多年，具有稳固的市场地位。联华电子在日本、韩国、新加坡、欧洲市场亦已经营多年，已建立完整的销售网络和服务体系。联华电子为台湾地区和美国的上市公司，基于上市地区或国家保护投资者的要求，因此将中国台湾地区、日本、韩国、北美洲、新加坡、欧洲市场划分给联华电子具有商业合理性，并且切实可行。

② 市场区域划分的有效性

从 2015 年起，发行人与联华电子及其关联方即开始严格执行市场区域划分的原则，报告期内，双方分别在对方市场区域销售晶圆和支付服务费或者给予的销售差价的具体情况如下：

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	2016 年
发行人在联华电子市场区域销售晶圆金额	177,987.68	133,203.35	98,988.42
发行人支付的服务费或给予的销售差价	563.85	387.07	269.41
联华电子在发行人市场区域销售晶圆金额	103,304.73	142,664.43	176,171.35
联华电子支付的服务费	365.34	486.24	594.49

联华电子在发行人市场区域销售晶圆金额从 2016 年的 176,171.35 万元快速下降到 2018 年的 103,304.73 万元，降幅 41.36%，而发行人在联华电子市场区域销售晶圆金额从 2016 年的 98,988.42 万元，增加到 2018 年的 177,987.68 万元，增幅高达 79.81%，发行人在发行人市场区域晶圆销售金额从 2016 年的 84,443.39 万元，增加到 175,702.94 万元，增幅高达 108.07%。因此，从发行人在国内外市场的销售情况看，上述市场区域划分原则均被有效执行，不会对公司产生重大不利的影响。



综上所述，报告期内，发行人的产能、产量、销量不断增加，而联华电子的产能、产量、销量保持稳定，因此市场区域的划分，有利于增强发行人自主拓展市场的能力，对发行人的持续盈利能力不构成重大不利影响；发行人、联华电子存在客户、供应商重合的情形，上述客户、供应商重合是由芯片制造行业特点所决定，发行人、联华电子对重合客户、供应商各自独立签订销售、采购合同，定价公允，发行人、联华电子不存在通过重合客户、供应商进行利益输送的情形，市场区域的划分不会影响发行人自主开拓客户的能力，对发行人持续经营发展不存在重大不利影响；发行人 12 英寸相关技术主要来自控股股东授权，发行人已完全掌握控股股东授权的最先进制程技术，完全可以满足生产经营的需要，对控股股东技术不存在重大依赖，发行人的核心制程工艺并未受制于控股股东，对发行人的持续经营不存在重大不利影响；虽然相关销售差价或服务金额相对销售收入金额占比很小，但相关销售差价或服务自 2015 年起即在严格执行并未因本次发行上市而进行调整，且价格确定依据合理，价格公允，保证了双方的公平、独立的市场竞争地位；竞争双方市场区域划分具有商业合理性，从报告期内发行人在国内外市场的销售情况看，在发行人市场区域内的，发行人晶圆销售收入增长，因此通过市场区域划分解决同业竞争的措施可行、有效，不会对发行人自主拓展相关市场、持续经营产生重大不利影响。

**2、在竞争方的同类收入或毛利占发行人该类业务收入或毛利的比例达 30%以上的情况下，认定对发行人不构成重大不利影响的依据是否充分，补充提供相关证据，并结合证据论证发行人是否符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的发行条件；**

(1) 按市场区域划分情况

报告期内，在发行人市场区域内，联华电子晶圆收入、毛利占发行人的比例情况如下：

单位：万元

年份	收入			毛利		
	联电	发行人	占比	联电	发行人	占比
2018 年	103,304.06	175,702.93	58.79%	17,014.05	-29,925.50	-56.85%
2017 年	142,664.75	187,993.48	75.89%	21,927.90	-60,359.40	-36.33%
2016 年	176,171.76	84,443.39	208.63%	29,583.94	14,813.70	199.71%

报告期内，在发行人市场区域内，联华电子晶圆收入占发行人的比例分别为 208.63%、75.89%、58.79%，逐年下降，下降幅度较大，发行人晶圆毛利为负数，故毛利占比不可比。

(2) 在市场区域划分基础上按细分产品划分情况

报告期内，由于技术或者产能等因素制约，发行人不具备部分产品的生产能

力，联华电子在发行人市场区域内销售的部分制程的产品发行人没有相应制程或收入，如 65nm、0.5  $\mu\text{m}$  以上等产品。在剔除这些产品的收入和毛利后，在发行人市场区域内，报告期内联华电子相应制程或工艺晶圆收入、毛利率占发行人的比例具体情况如下：

年份	收入			毛利		
	联电	发行人	占比	联电	发行人	占比
2018 年	48,843.55	175,702.94	27.80%	10,188.97	-29,925.50	-34.05%
2017 年	104,168.39	187,993.48	55.41%	15,789.25	-60,359.38	-26.16%
2016 年	65,688.58	84,443.39	77.79%	12,033.16	14,813.68	81.23%

2018 年，在发行人市场区域内，在剔除联华电子 65nm、0.5  $\mu\text{m}$  以上等相对于发行人没有的制程或产品收入后，联华电子相应制程或工艺晶圆收入、毛利率占发行人的比例为 27.80%，未超过 30%。由于发行人晶圆毛利为负数，故毛利占比不具有可比性。

### （3）发行人及控股股东进一步承诺

报告期内，发行人 8 英寸产能一直处于满载状态，已无多余的产能来接新的订单，待募投项目实施后，发行人将有更多的产能消化发行人市场区域内的订单。报告期内发行人子公司厦门联芯产能利用率较低，厦门联芯将加大 12 英寸先进制程和特色工艺研发力度提升产能利用率。在募投项目扩充 8 英寸产能、提高 12 英寸的产能利用率后，发行人将进一步拓展发行人市场区域内的客户，提高市场占有率，降低联华电子在发行人市场区域内晶圆销售比例。

联华电子于 2019 年 5 月 22 日出具承诺函，联华电子将采取合法措施承诺在 2020 年 12 月 31 日前在和舰芯片的市场区域内联华电子的同类收入占和舰芯片该类业务收入的比例降至 30% 以下；在厦门联芯连续盈利年度的次年起，在和舰芯片的市场区域内联华电子的同类业务毛利占和舰芯片该类业务毛利的比例降至 30% 以下。2018 年 8 月 20 日，联华电子召开 2018 年第一次股东临时会议，通过《避免同业竞争协议》并授权董事会、董事长或其指定之人，修改并签署避免同业竞争协议，该承诺作为 2018 年 8 月双方签署的《避免同业竞争协议》的补充由联华电子董事长签署，履行了联华电子相应决策程序。

综上所述，2018 年，在发行人市场区域内，虽然按照市场区域划分，联华电子在发行人市场区域销售占比超过 30%，但由于技术或者产能等因素制约，发行人不具备部分产品的生产能力，在剔除联华电子 65nm、0.5  $\mu\text{m}$  以上等相对于发行人没有的制程或产品的收入后，联华电子相应制程或工艺晶圆收入占比未超过 30%，发行人毛利率为负不具有可比性，符合《注册管理办法》（试行）、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》中的有关规定。随着募投项目 8 英寸

产能的扩充、12英寸的产能利用率的提高，发行人将进一步拓展发行人市场区域内的客户，提高市场占有率，降低联华电子在发行人市场区域内晶圆销售比例。同时联华电子已承诺将采取合法措施在2020年12月31日前在和舰芯片的市场区域内联华电子的同类收入占和舰芯片该类业务收入的比例降至30%以下；在厦门联芯连续盈利年度的次年起，在和舰芯片的市场区域内联华电子的同类业务毛利占和舰芯片该类业务毛利的比例降至30%以下。因此发行人与联华电子的同业竞争对发行人不构成重大不利影响，依据充分，符合《注册管理办法》（试行）、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》的相关规定。

### 3、说明美国联电收取的代理费与日本联电收取的代理费差异较大的原因及合理性，定价依据及其公允性。

发行人在美国、日本通过美国联电、日本联电进行经销，美国联电、日本联电获取销售差价。根据美国、日本的税务机关确定或认可的销售利润率来确认美国联电、日本联电需要向发行人收取的销售差价。其中，报告期内美国税务机关为美国联电确定销售利润率为1.09%，为满足此销售利润率美国联电需要向发行人收取的销售差价率为1%。日本税务机关认可的日本联电的销售利润率如下：

期间	2015年4月-2016年4月	2016年4月-2016年8月	2016年8月-2017年4月	2017年4月至目前
日本税收机关认可的销售利润率	1.17%	1.41%	1.41%	1.49%
计算的相关销售差价率	2%	3%	5%	2.5%

注：2016年4月-8月和2016年8月-2017年4月在税务机关认可的相同利润率的情况下，折算的相关销售差价率差异较大的原因日本联电的销售收入有较大幅度的下降，为满足日本税务机关认可的销售利润率，因而较大幅度的提高了销售差价率。

美国联电和日本联电获取的销售差价率差异较大的主要原因是税务机关确定或认可的销售利润率、两个公司在所在国的销售收入、运营成本的不同所致。

此外，报告期内美国联电和日本联电获取的销售差价金额较小，具体情况如下：

单位：万元

期间	2018年度	2017年度	2016年度
发行人向美国联电销售金额	20,598.30	9,833.24	8,675.40
美国联电获取的销售差价	214.61	99.44	86.76
发行人向日本联电销售金额	5,734.5	4,556.96	3,285.12
日本联电获取的销售差价	191.33	182.92	90.65

美国联电、日本联电向发行人获取的销售差价需要根据美国、日本税务机关

确认或者认可的销售利润率并依据两个公司具体销售、运营成本情况进行调整。定价具有商业合理性，价格公允。

综上所述，报告期内美国联电与日本联电向发行人获取的差价金额较小，美国联电与日本联电获取的差价差异较大，这主要系税务机关确定或认可的销售利润率、两个公司在所在国的销售收入、运营成本的不同所致；定价具有商业合理性，价格公允。

**4、请发行人披露以地域、细分产品划分解决同业竞争问题的做法是否符合相关监管要求。请进一步提出解决同业竞争的切实可行的方案，避免给发行人带来重大不利影响。**

(1) 请发行人披露以地域、细分产品划分解决同业竞争问题的做法是否符合相关监管要求

① 发行人通过划分市场区域解决同业竞争的做法符合《注册管理办法》（试行）、《问答》的相关规定

联华电子及其控制的其他企业的市场区域为台湾、北美洲、日本、新加坡、韩国、欧洲，发行人的市场区域为中国大陆地区以及联华电子及其控制的其他企业市场区域外的全球其他国家或地区。

发行人与联华电子在各自的市场区域发展多年，已建立完整的销售网络和服务体系，形成了稳固的市场地位，此外，联华电子作为美国和台湾地区的上市公司亦需要保护两地的投资者，因而市场区域的划分的原则具有商业合理性，同时从报告期内发行人在国内外市场的销售情况看，在发行人市场区域内的，发行人晶圆销售收入增长，对于发行人及联华电子及其关联方进入对方市场领域销售的情况，双方均支付了服务费或者获取了销售差价，定价公允，且自 2015 年起发行人与联华电子及其关联方开始执行，并未因发行人本次发行上市而调整，通过市场区域划分解决同业竞争切实、有效，并保证了双方的公平竞争地位。

报告期内，发行人与联华电子及其关联方均独立按照市场竞争地位开发客户，争取订单，发行人与联华电子及其关联方之间不存在相互或者单方让渡商业机会的情形。

发行人、联华电子对重合客户、供应商各自独立签订销售、采购合同，价格基本公允，不存在利益输送的情况。

2018 年，虽然按照市场区域划分，联华电子在发行人市场区域销售占比为 58.79%，占比超过 30%，但由于技术或者产能等因素制约，发行人不具备部分产品的生产能力，在剔除联华电子 65nm、0.5  $\mu\text{m}$  以上等相对于发行人没有的制程或产品的收入后，联华电子相应制程或工艺晶圆收入占比为 27.80%，占比未超过 30%，发行人毛利率为负不具有可比性，符合《注册管理办法》（试行）、《上海

证券交易所科创板股票发行上市审核问答》中的有关规定。随着募投项目 8 英寸产能的扩充、12 英寸的产能利用率的提高，发行人将进一步拓展发行人市场区域内的客户，提高市场占有率，降低联华电子在发行人市场区域内晶圆销售比例。同时联华电子已承诺将采取合法措施在 2020 年 12 月 31 日前在和舰芯片的市场区域内联华电子的同类收入占和舰芯片该类业务收入的比例降至 30%以下；在厦门联芯连续盈利年度的次年起，在和舰芯片的市场区域内联华电子的同类业务毛利占和舰芯片该类业务毛利的比例降至 30%以下。

因此，联华电子与发行人通过划分市场区域解决同业竞争对发行人不构成重大不利影响，符合《注册管理办法》（试行）、《问答》的相关规定。

②发行人与联华电子签署了《避免同业竞争的协议》确定了市场划分的原则，该协议的签署已履行各自法定的审批程序

2018 年 8 月 20 日，联华电子召开 2018 年第一次股东临时会议，通过《避免同业竞争协议》并授权董事会、董事长或其指定之人、及/或授权子公司董事会或其授权之人(依其情形适用之)，修改并签署避免同业竞争协议。就上述《避免同业竞争协议》，发行人间接股东菁英国际、晶信科技、橡木联合亦已履行了各自决策程序。

2019 年 3 月 17 日，发行人召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于签订〈避免同业竞争协议〉的议案》。

发行人与联华电子签署了《避免同业竞争的协议》确定了市场划分的原则，该协议的签署已履行各自法定的审批程序，合法有效。

### ③以市场区域划分解决同业竞争的相关案例

公司名称	解决同业竞争的方法	具体内容
长飞光纤 (600189)	划分市场区域	针对长飞光纤与公司第一大股东德拉克科技（及其关联公司）之间可能存在的同业竞争问题，双方于 2008 年 10 月 13 日签署了《光纤技术合作协议》，就光纤预制棒、光纤和光缆销售的全球市场进行划分，并分别于 2013 年 8 月 27 日、2014 年 5 月 30 日就协议期限的延长等事项进一步签署相关协议，德拉克科技（及其关联公司）的业务区域为欧洲、北美洲、南美洲以及除以色列以外的中东地区（以下简称“德拉克区域”），而长飞光纤的业务区域主要集中在亚洲（除中东外，但包括以色列）（以下简称“长飞区域”）。在非洲和除德拉克区域、长飞区域外的其它地区，德拉克科技（及其关联公司）和长飞光纤以独立途径和相互协调的方式，继续服务现有客户。
亚翔集成 (603929)	划分市场区域	根据亚翔集成和控股股东台湾亚翔 2008 年 11 月 13 日签署的《避免同业竞争协议》，台湾亚翔在中国台湾、越南、新加坡、马来西亚、印度独占地从事洁净室工程服务及机电安装工程服务，亚翔集成在上述区域之外的其他全部地区独占地从事洁净室工程服务及机电安装工程服务。2012 年 4 月 6 日，为了进一步增强亚

		翔集成未来的持续发展能力，亚翔集成和台湾亚翔签署了《避免同业竞争协议之补充协议》，将印度市场划归亚翔集成独占地从事洁净室工程服务及机电安装工程服务。
工业富联 (601138)	细分产品+划分市场区域	<p>细分产品：鸿海精密控制的富智康与富士康股份生产并销售的手机高精金属机构件面向不同的品牌客户，富士康股份及其控股子公司主要面向某美国知名品牌客户生产并销售手机高精金属机构件；富智康存在为富士康股份及其控股子公司提供代工服务而生产上述美国知名品牌手机高精金属机构件的情况，但并未以其自身名义从事该品牌手机高精金属机构件的生产及销售业务。</p> <p>划分市场区域：鸿海精密控制的除中坚公司及其控股子公司以外的子公司中，Foxconn MOEBG Industria de Eletronicos Ltda. 和 Foxconn Brasil Indústria e Comércio Ltda. 注册于巴西，分别从事机顶盒、线缆模组的生产与销售及笔记本电脑、智能手机、服务器和主板的生产与销售，鸿海精密分别间接持有两家公司 100% 权益；上述两家公司仅在巴西境内开展业务，与发行人及其控股子公司的业务区域并无重叠，且其业务规模相对较小，收入、利润与发行人及其控股子公司同类型业务相比较低，与发行人及其控股子公司不存在实质性的同业竞争。</p>

长飞光纤划分市场区域后，从 2014 年至 2017 年上半年，在长飞光纤的市场区域内（主要是大陆），德拉克及其关联方的相关产品的销售金额占长飞光纤的比例为 1.49%、1.42%、1.29% 和 2.21%。亚翔集成是工程类公司，在市场区域划分后，亚翔集成与台湾亚翔在各自的市场区域内未发生业务重叠的情况，台湾亚翔在亚翔集成的市场区域内未从事相关竞争业务。工业富联招股书和年报未披露竞争方在工业富联市场区域内的销售情况，无法获得相关数据。长飞光纤、亚翔集成、工业富联均在主板上市，是在不允许同业竞争的情况下采取通过市场区域划分或细分产品解决同业竞争。

综上所述，发行人与联华电子通过划分市场区域解决同业竞争对发行人不构成重大不利影响，符合《注册管理办法》（试行）、《问答》的相关规定；双方签署了《避免同业竞争的协议》确定了市场划分的原则，该协议的签署已履行各自法定的审批程序；在首次公开发行股票时，长飞光纤、亚翔集成主要通过划分市场区域，工业富联通过细分产品和划分市场区域来解决同业竞争。因此以地域、细分产品划分解决同业竞争问题的做法符合相关监管要求。

(2) 请进一步提出解决同业竞争的切实可行的方案，避免给发行人带来重大不利影响。

A、发行人通过募投项目扩充 8 英寸产能、提高 12 英寸的产能利用率，进一步拓展发行人市场区域内的客户，提高市场占有率，降低联华电子在发行人市场区域内晶圆销售比例。

报告期内，发行人 8 英寸产能一直处于满载状态，2018 年产能利用率达

111.17%，已无多余的产能来接新的订单，待募投项目实施后，发行人8英寸晶圆将在现有产能77万片/年的基础上增加至114万片/年，发行人将有更多的产能消化发行人市场区域内的订单。

发行人子公司厦门联芯2018年的产能利用率仅有56.44%。为提升产能利用率，发行人将加大12英寸先进制程和特色工艺研发力度，特别是5G、人工智能、物联网等前沿芯片技术研发力度，提高自身制程范围，积极向更先进制程迈进，同时努力开拓各个制程特色工艺。

B、根据《避免同业竞争协议》的约定，联华电子保证发行人具有优先发展、优先受让权和中國大陸境外具有优先受让权：在发行人的市场区域范围内，联华电子将任何可从事、参与、入股、经营、协助、支持或介入任何可能与发行人及其控股/控制企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争业务的商业机会以公平合理之条款让与发行人；在发行人的市场区域范围内，将与发行人主营业务相关的新产品或技术以公平合理的条款授予发行人及其控股/控制企业优先生产或受让的权利；在中國大陸境外，如有联华电子或联华电子控股企业拟向第三方转让或出售或以其它方式转让或允许使用全部或部分晶圆产品的资产、权益，发行人同等条件下具有优先受让权。

C、2019年5月22日，联华电子出具承诺，联华电子将采取合法措施承诺在2020年12月31日前在和舰芯片的市场区域内本公司的同类收入占和舰芯片该类业务收入的比例降至30%以下；在厦门联芯连续盈利年度的次年起，在和舰芯片的市场区域内本公司的同类业务毛利占和舰芯片该类业务毛利的比例降至30%以下。

### (3) 本所律师对上述事项的核查及结论

#### ① 核查过程

本所律师会同保荐机构通过取得联华电子工商登记资料、取得双方签署的《销售服务合约》、双方在各自市场区域销售情况统计表、发行人与最终控股股东及其关联方在相关产品产能、产量、销量、毛利率等情况，查阅联华电子年报及其他公告、查阅行业研究报告，询问发行人和联华电子业务和财务人员等方式对竞争双方市场通过市场区域划分解决同业竞争的情况进行了核查。

#### ② 核查结论

A、报告期内，发行人的产能、产量、销量不断增加，而联华电子的产能、产量、销量保持稳定，因此市场区域的划分，有利于增强发行人自主拓展市场的能力，对发行人的持续盈利能力不构成重大不利影响；发行人、联华电子存在客户、供应商重合的情形，上述客户、供应商重合是由芯片制造行业特点所决定，发行人、联华电子对重合客户、供应商各自独立签订销售、采购合同，定价公允，发

行人、联华电子不存在通过重合客户、供应商进行利益输送的情形，市场区域的划分不会影响发行人自主开拓客户的能力，对发行人持续经营发展不存在重大不利影响；发行人 12 英寸相关技术主要来自控股股东授权，发行人已完全掌握控股股东授权的最先进制程技术，完全可以满足生产经营的需要，对控股股东技术不存在重大依赖，发行人的核心制程工艺并未受制于控股股东，对发行人的持续经营不存在重大不利影响；虽然相关销售差价或服务费金额相对销售收入金额占比很小，但相关销售差价或服务费自 2015 年起即在严格执行并未因本次发行上市而进行调整，且价格确定依据合理，价格公允，保证了双方的公平、独立的市场竞争地位；竞争双方市场区域的划分的具有商业合理性，从报告期内发行人在国内外市场的销售情况看，在发行人市场区域内的，发行人晶圆销售收入增长，因此通过市场区域划分解决同业竞争的措施可行、有效，不会对发行人自主拓展相关市场、持续经营产生重大不利影响。

B、2018 年，在发行人市场区域内，虽然按照市场区域划分，联华电子在发行人市场区域销售占比超过 30%，但由于技术或者产能等因素制约，发行人不具备部分产品的生产能力，在剔除联华电子 65nm、0.5  $\mu\text{m}$  以上等相对于发行人没有的制程或产品的收入后，联华电子相应制程或工艺晶圆收入占比未超过 30%，发行人毛利率为负不具有可比性，符合《注册管理办法》（试行）、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》中的有关规定。随着募投项目 8 英寸产能的扩充、12 英寸的产能利用率的提高，发行人将进一步拓展发行人市场区域内的客户，提高市场占有率，降低联华电子在发行人市场区域内晶圆销售比例。同时联华电子已承诺将采取合法措施在 2020 年 12 月 31 日前在和舰芯片的市场区域内联华电子的同类收入占和舰芯片该类业务收入的比例降至 30% 以下；在厦门联芯连续盈利年度的次年起，在和舰芯片的市场区域内联华电子的同类业务毛利占和舰芯片该类业务毛利的比例降至 30% 以下。因此发行人与联华电子的同业竞争对发行人不构成重大不利影响，依据充分，符合《注册管理办法》（试行）、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》的相关规定。

C、报告期内美国联电与日本联电向发行人获取的差价金额较小，美国联电与日本联电获取的差价差异较大，这主要系税务机关确定或认可的销售利润率、两个公司在所在国的销售收入、运营成本的不同所致；定价具有商业合理性，价格公允。

D、发行人与联华电子通过划分市场区域解决同业竞争对发行人不构成重大不利影响，符合《注册管理办法》（试行）、《问答》的相关规定；双方签署了《避免同业竞争的协议》确定了市场划分的原则，该协议的签署已履行各自法定的审批程序；在首次公开发行股票时，长飞光纤、亚翔集成主要通过划分市场区域，



工业富联通过细分产品和划分市场区域来解决同业竞争。因此以地域、细分产品划分解决同业竞争问题的做法符合相关监管要求。

## 二、《问询函》2. 关于独立性

发行人 0.13um、28nm、40nm、55nm、80nm 及 90nm 制程晶圆制造技术均来自联华电子授权使用，且非独占、排他的许可方式。根据联华电子出具的确认函，授权技术到期后如经相关政府部门核准同意续展使用期限，将免费供发行人使用。根据回复材料：发行人已经完全掌握 28nm、40nm 等先进制程技术，已对控股股东技术不存在重大依赖，技术授权协议到期后继续授权是为了避免被第三方起诉而引起不必要的知识产权纠纷。发行人对台湾地区、日本、北美洲等主要市场的销售要通过控股股东联华电子及其关联方进行，发行人与联华电子及其关联方之间存在较多关联交易。

请发行人披露：（1）报告期各类产品涉及主要技术的取得方式，发行人向联华电子支付技术授权费用的确定依据，包括但不限于联华电子对应相关产品的开发总成本、分摊的依据、一定利润的具体水平、制程权利金占使用该制程所创造之收入比例的具体水平，是否公允、合理；（2）联华电子如将相关技术授权其他主体使用，对发行人的具体影响，是否会与发行人形成新的竞争；（3）授权技术到期后续展需要哪些政府部门核准，充分披露如果无法核准对发行人的影响；（4）公司已经完全掌握了 28nm、40nm 等先进制程技术，已对控股股东技术不存在重大依赖是否符合企业的实际情况，如果已完全掌握，能否在不依赖于授权技术的情况下独立研发、生产；技术协议到期后如果无法继续授权，会引起与哪些第三方的知识产权纠纷，涉及哪些知识产权；（5）公司是否具备“研发-制造-销售”的一体化完备的产业链条，是否具备自我创新驱动发展的动能和持续的盈利能力，公司是否是真正拥有自主知识产权的产业化公司，是否符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法》“发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力”的要求；（6）公司未对境外股权、业务进行重组的原因，有无将芯片相关核心技术及研发平台均从境外转移到发行人，以提高自主创新能力和独立性的方案；（7）结合报告期内发行人通过联华电子及其关联方代销产品金额占收入总额的比例，说明在发行人对台湾地区、日本、北美洲等主要市场的销售要通过控股股东联华电子及其关联方进行的情况下，回复材料认为发行人拥有完整独立的销售服务体系是否符合企业实际情况；（8）联华电子对下属晶圆制造厂与发行人在管理上的异同，发行人是否实质上属于联华电子的生产基地，在产供销和技术上对联华电子是否存在重大依赖，发行人是否具备独立经营和开拓市场的能力，是否构成本次发行上市障碍。

请发行人说明，若不能取得联华电子的技术授权，对发行人生产经营的具

体影响，并结合该影响说明是否对联华电子存在技术依赖。

请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查，并发表明确意见。

回复：

本所律师会同保荐机构通过取得发行人授权技术契约、取得发行人授权技术和非授权技术报告期收入和毛利统计表、询问发行人财务人员及业务人员、询问联华电子信息披露人员、询问台湾普华律师等方式对发行人报告期取得控股股东授权技术及对发行人生产经营和独立性的影响等情况进行了核查，具体情况如下：

**1、报告期各类产品涉及主要技术的取得方式，发行人向联华电子支付技术授权费用的确定依据，包括但不限于联华电子对应相关产品的开发总成本、分摊的依据、一定利润的具体水平、制程权利金占使用该制程所创造之收入比例的具体水平，是否公允、合理；**

(1) 报告期各类产品涉及主要技术的取得方式

序号	制程或工艺	取得方式
1	0.11 μm 嵌入式 pFlash 低功耗工艺	自主研发
2	0.11 μm 嵌入式 pFlash 超低功耗工艺	自主研发
3	0.11μm 嵌入式 EEPROM 低功耗工艺	自主研发
4	0.11 μm 逻辑工艺	授权
5	0.11 μm 混合信号工艺	授权
6	0.15 μm 制程及工艺	自主研发
7	0.18 μm 制程及工艺	自主研发
8	0.25 μm 制程及工艺	自主研发
9	0.35 μm 制程及工艺	自主研发
10	0.5 μm 制程及工艺	自主研发
11	80/90nm 制程及工艺	技术授权基础上进行定制化开发
12	40/55nm 制程及工艺	技术授权基础上进行定制化开发
13	28nm 制程及工艺	技术授权基础上进行定制化开发

(2) 发行人向联华电子支付技术授权费用的确定依据，包括但不限于联华电子对应相关产品的开发总成本、分摊的依据、一定利润的具体水平、制程权利金占使用该制程所创造之收入比例的具体水平，是否公允、合理

公司技术授权费的定价分别是按照和舰芯片或者厦门联芯授权技术产能占联华电子相应产能的比例，分摊制程的开发总成本加上一定的利润，同时考虑制程权利金占使用该制程所创造之收入比例确定。

由于晶圆制造行业制程技术授权不公布权利金的金额，而且本公司也未从非关联第三方取得制程授权，因而本公司无法获取同行业同类型技术授权收费情况。上述技术授权费用充分考虑和舰芯片或者厦门联芯授权技术产能占联华电子相应产能的比例，分摊制程的开发总成本加上一定的利润，同时考虑制程权利金占使用该制程所创造之收入比例确定。上述授权技术的开发成本均为实际的开发支出，

分摊的依据、利润加成、考虑的销售收入分成率均在合理的区间，授权技术的定价公允、合理。

## 2、联华电子如将相关技术授权其他主体使用，对发行人的具体影响，是否会与发行人形成新的竞争；

发行人作为联华电子的控股子公司，两者的公司利益有一致性，在和舰芯片市场区域内联华电子将相关技术授权其他主体使用，从而对发行人构成新的竞争不存在商业合理性。

发行人报告期依托自主技术和股东授权技术对生产经营和财务状况的贡献情况如下：

单位：万元

项目	2018年		2017年		2016年	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
自主技术	219,362.55	62.02%	207,561.46	64.62%	171,839.64	93.68%
授权技术	134,328.06	37.98%	113,635.37	35.38%	11,592.17	6.32%
合计	353,690.61	100%	321,196.83	100%	183,431.81	100%
项目	2018年		2017年		2016年	
	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比
自主技术	69,680.45	-	69,028.09	-	47,067.36	-
授权技术	-204,736.71	-	-136,229.42	-	-12,278.38	-
合计	-135,056.27	-	-67,201.33	-	34,788.98	-

报告期发行人自主技术带来的收入分别为 171,839.64 万元、207,561.46 万元和 219,362.55 万元，占发行人晶圆制造收入的比例为 93.68%、64.62%和 62.02%；发行人毛利全部来自自主技术，发行人自主技术产生的毛利分别为 47,067.36 万元、69,028.09 万元和 69,680.45 万元，报告期授权技术对发行人毛利贡献为负。综合报告期授权技术对发行人收入和毛利的贡献情况，发行人生产经营对授权技术不存在重大依赖，即使联华电子将相关技术授权其他主体使用，也不会对发行人构成重大不利影响。

2019年5月22日，联华电子出具承诺：根据发行人与联华电子于2019年3月2日签署的《避免同业竞争的协议》的约定，在发行人的市场区域范围内，联华电子将任何可从事、参与、入股、经营、协助、支持或介入任何可能与发行人及其控股/控制企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争业务的商业机会以公平合理之条款让与发行人。根据此约定，在发行人的市场区域内，联华电子不会将相关技术授权其他主体使用。

综上所述，发行人生产经营对授权技术不存在重大依赖，即使联华电子将相关技术授权其他主体使用，不会对发行人构成重大不利影响；根据联华电子出具的承诺函，在发行人的市场区域内，联华电子不会将相关技术授权其他主体使用，

不会与发行人构成新的竞争。

### **3、授权技术到期后续展需要哪些政府部门核准，充分披露如果无法核准对发行人的影响；**

根据台湾普华律师出具的《法律意见书》，公司控股股东联华电子授权发行人技术到期后需要台湾经济部投资审议委员会核准，根据台湾地区目前的相关政策，在满足《作业要点》要求下技术授权批复不存在障碍，控股股东联华电子授权发行人 0.13 μm 技术到期后已于 2018 年 7 月成功免费续展，因此公司不能获得授权可能性较小。如果无法核准对发行人持续经营不会产生重大影响，具体分析如下：

(1) 发行人通过在引进吸收的基础上进行客制化和差异化研究，已经完全掌握控股股东授权技术，继续获得授权只是为了避免知识产权方面的纠纷。

(2) 联华电子拥有上述知识产权相关的专利权、商业秘密、集成电路布局权及其他相关知识产权，并将其授权给发行人使用。如果发行人使用上述授权技术引致第三方以侵害其专利权或其他智慧财产权为由起诉者，联华电子将赔偿发行人因此所支付的律师费、诉讼费用、损害赔偿金及发行人因此所受的直接损害。

(3) 联华电子已出具确认函，联华电子授权和舰芯片、厦门联芯使用的技术到期后和舰芯片、厦门联芯可继续使用，联华电子不采取任何方式阻止或阻挠和舰芯片、厦门联芯继续使用，亦不在任何地方或区域对和舰芯片、厦门联芯提起诉讼或提起仲裁。

(4) 根据台湾普华律师事务所出具的普字第 19003085 号《法律意见书》，发行人通过自行研发或从第三方取得不落后或优于联华电子之技术时，不受《作业要点》的限制或约束。因此发行人在未来市场需要及资金实力允许的情况下，可以自行研发或者向第三方购买更先进制程技术。

因此即便到期后如果无法取得台湾经济部投资审议委员会核准，发行人仍然可以继续使用上述技术，还可以通过自行研发或从第三方取得不落后或优于联华电子之技术，不会对发行人产生重大不利影响。

本所律师经核查认为，根据台湾地区目前的相关政策，在满足《作业要点》要求下发行人授权技术到期后取得授权不存在障碍，发行人已经完全掌握相关授权技术，到期后继续续展只是为了避免第三方知识产权方面的纠纷。即便到期后如果无法取得台湾经济部投资审议委员会核准，发行人仍可以使用上述授权技术，并可以通过自行研发或从第三方取得不落后或优于联华电子之技术，不会对发行人产生重大不利影响。

### **4、公司已经完全掌握了 28nm、40nm 等先进制程技术，已对控股股东**

**技术不存在重大依赖是否符合企业的实际情况，如果已完全掌握，能否在不依赖于授权技术的情况下独立研发、生产；技术协议到期后如果无法继续授权，会引起与哪些第三方的知识产权纠纷，涉及哪些知识产权；**

(1) 公司已经完全掌握了 28nm、40nm 等先进制程技术，已对控股股东技术不存在重大依赖是否符合企业的实际情况，如果已完全掌握，能否在不依赖于授权技术的情况下独立研发、生产；

A、联华电子授权厦门联芯 28nm、40nm 是完整技术，包含制程技术、设计规则、电路布线、光罩图形档案、光罩等，厦门联芯引进吸收后技术上无需依赖联华电子，同时也为以后进行差异化特色工艺研发提供了良好的基础。

B、报告期，通过引进吸收联华电子 28nm、40nm 等先进制程技术，自 2016 年 6 月开始 40nm 试产，短短 2 年时间，和舰芯片子公司厦门联芯 28nmHLP SiON、28nm HKMG 及 40nm 制程技术已量产多家客户产品，良率达到联华电子同等水平。

C、厦门联芯已经建立了自己研发、生产团队，截止 2018 年底，厦门联芯已有 140 名研发人员，仍在全球招募研发方面的人才。以自有资金建立 12 英寸晶圆研发中心，专注于 12 英寸先进和特色工艺研发，目前正在引进吸收基础上独立进行差异化研发，并正在实施厦门联芯人工智能、5G 等先进芯片技术研发及应用项目，其中计划结合发行人 28HKMG 工艺独创 ReRAM 芯片技术，并将其提升至 22nm，在目前嵌入式非挥发性记忆体工艺中最具竞争力。目前已经研发完成 28nm RF/mmWave 特色工艺，达到国际先进水平。

公司部分核心机台具备生产更先进制程的能力，为公司研发更先进制程提供了相关的设备基础。

D、根据台湾普华律师事务所出具的普字第 19003085 号《法律意见书》，发行人通过自行研发或从第三方取得不落后或优于联华电子之技术时，不受《作业要点》的限制或约束。因此发行人在未来市场需要及资金实力允许的情况下，可以自行研发或者向第三方购买更先进制程技术。

因此，厦门联芯通过引进吸收已经完全掌握 28nm、40nm 等先进制程技术，符合企业实际情况，可以在不依赖于授权技术的情况下独立研发、生产，且发行人具备自行独立研发的条件及能力，不受相关法律限制。

(2) 技术协议到期后如果无法继续授权，会引起与哪些第三方的知识产权纠纷，涉及哪些知识产权；

联华电子拥有上述知识产权相关的专利权、商业秘密、集成电路布局权及其他相关知识产权，并将其授权给发行人使用。因为公司并不拥有上述授权技术的知识产权，集成电路制造技术极其复杂，各个主要厂商使用的技术难免有相同或

相似环节。如果到期后无法续展，行业内第三方可能会以侵犯专利权或其他知识产权为由起诉发行人。但联华电子确认如果发行人使用上述授权技术引致第三方以侵害其专利权或其他知识产权为由起诉发行人，联华电子将赔偿发行人因此所支付的律师费、诉讼费用、损害赔偿金及发行人因此所受的直接损害。因此不会对发行人经营产生重大不利影响。

本所律师经核查认为，厦门联芯通过引进吸收已经完全掌握 28nm、40nm 等先进制程技术，符合企业实际情况，厦门联芯已建立自己完整的研发、生产团队，可以在不依赖于授权技术的情况下独立研发、生产。联华电子拥有授权技术对应的专利权、商业秘密、集成电路布局权及其相关知识产权，并承诺到期后即便无法续期还会供发行人使用也不会因此起诉发行人，但集成电路制造技术极其复杂，行业内第三方技术难免有相同或相似环节，如果到期后无法续展，行业内第三方可能会以侵犯专利权或其他知识产权为由起诉发行人。联华电子已经承诺如果发行人使用上述授权技术引致第三方以侵害其专利权或其他知识产权为由起诉发行人，联华电子将赔偿发行人因此所支付的律师费、诉讼费用、损害赔偿金及发行人因此所受的直接损害。因此不会对发行人经营产生重大不利影响。

**5、公司是否具备“研发-制造-销售”的一体化完备的产业链条，是否具备自我创新驱动发展的动能和持续的盈利能力，公司是否是真正拥有自主知识产权的产业化公司，是否符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法》“发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力”的要求；**

(1) 公司是否具备“研发-制造-销售”的一体化完备的产业链条

发行主要从事 12 英寸及 8 英寸晶圆研发制造业务，独立完整的拥有晶圆制造业务相关的研发、生产、采购、销售体系，具有面向市场独立持续经营的能力。

①发行人已建立了完整的研发体系。截止报告期末发行人拥有研发人员 420 余人，报告期通过自主研发和吸收引进控股股东先进技术，并进行客制化和差异化研发，形成了大量的研发成果，部分研发成果比如 0.11  $\mu\text{m}$  嵌入式 pFlash 低功耗工艺平台、0.11  $\mu\text{m}$  嵌入式 pFlash 超低功耗工艺平台、0.11  $\mu\text{m}$  嵌入式 EEPROM 低功耗工艺平台等 8 英寸先进和特色制程工艺等为发行人独有，公司还储备了大量的研发项目。

②发行人拥有 8 英寸厂一座，12 英寸厂一座，可以为客户生产制造相关的 8 英寸和 12 英寸晶圆产品。

③发行人已建立了直销为主、经销为辅的完整的销售体系，具有独立面向市场销售的能力。

(2) 是否具备自我创新驱动发展的动能和持续的盈利能力，公司是否是真正

拥有自主知识产权的产业化公司

①是否具备自我创新驱动发展的动能

A、公司长期致力于成为国内集成电路制造行业的领先者，国内一流晶圆制造的供应商、服务商。公司将努力达成 8 英寸晶圆和 12 英寸晶圆制造产业链完整、基础设施配套齐全、规模领先以及工艺技术先进的目标，向产业高端化、产品差异化方向发展。公司致力于 8 英寸 0.5 $\mu\text{m}$  至 0.11 $\mu\text{m}$  制程系列晶圆产品和 12 英寸 40nm 和 28nm 及更先进制程晶圆系列产品的研发、生产和销售。公司加强科技投入，力争在新产品研发、生产装置技改等方面取得较大突破，打破国际技术垄断。

B、发行人建立完整的研发体系。截止 2018 年底，公司共有研发人员 420 余人，占公司员工总数的 13.19%。

本公司核心技术人员为高明正先生、蔡佩源先生、华寿崧先生，均具有集成电路相关专业背景，参与了公司电源管理、嵌入式快闪存储器等特色工艺的开发，取得了丰富的研发成果。

未来公司将持续改善研发激励机制，引进更多的优秀人才，加强在先进制程和特色工艺制程上的设计、研发力度，提高公司的技术优势和竞争力。

C、报告期公司通过加大研发力度，取得了丰硕的研发成果。公司报告期累计研发投入 86,568.80 万元，占公司最近三年累计营业收入的比例为 9.69%。公司最近三年完成了 0.11 $\mu\text{m}$  超低功耗嵌入式快闪存储器、0.13 $\mu\text{m}$  高压+/-16V 金属氧化物半导体、0.18 $\mu\text{m}$  BCD 高压 60V 工艺、0.11 $\mu\text{m}$  超小单元可擦写可编程存储器等 8 英寸特色工艺研发项目，通过在引进吸收联华电子 28nm、40nm 等先进制程技术的基础上进行了客制化、差异化研发，完成了多项 28nm、40nm 先进制程及特色工艺研发成果，形成了 12 英寸核心技术体系。为下一步进行先进制程及特色工艺打下了良好的基础。

D、公司目前正在进行 0.11  $\mu\text{m}$  SP+LL 嵌入式快闪存储器、0.18  $\mu\text{m}$  BCD 低导通电阻高压制程、28nm HPCu+（高效能低成本）工艺技术、40nm 嵌入式高压（20V）工艺技术、55 纳米低功率工艺技术等先进制程和特色工艺的研发。同时正在进行人工智能、5G 等前沿芯片技术研发，其中计划结合发行人 28HKMG 工艺独创 ReRAM 芯片技术，并将其提升至 22nm，在目前嵌入式非挥发性记忆体工艺中最具竞争力。目前已经研发完成 28nm RF/mmWave 特色工艺，达到国际先进水平。

公司现有部分核心设备具备研发、生产更先进制程的能力，为公司进行更先进制程研发提供了设备基础。

综上，公司已建立完整、高效的研发体系、报告期取得了丰富的研发成果，具备持续创新能力，公司现有研发团队、研发设备和研发能力具备突破关键核心技术的基础和潜力。

## ②是否具备持续的盈利能力

2016年度至2018年公司营业收入分别为187,764.48万元、335,988.64万元与369,403.22万元，营业收入持续增长；公司归属于母公司所有者的净利润分别为-14,390.50万元、7,128.79万元、2,992.72万元，公司经营活动产生的现金流量净额分别为126,710.16万元、291,321.95万元和320,550.51万元，经营性现金流良好，具有持续产生现金流的能力。

公司母公司净利润分别为28,531.52万元、40,768.95万元和50,939.88万元，公司母公司盈利能力持续增长，年复合增长率达到33.62%。

公司报告期内尚未盈利主要是由于公司子公司厦门联芯2016年底建成投产，12英寸先进制程生产线投资巨大，前期固定资产折旧和无形资产摊销太大导致毛利率为负且需计提存货减值和预计负债所致；不考虑折旧摊销因素，报告期内发行人息税折旧摊销前利润分别为-46,915.48万元、152,276.68万元、113,496.61万元。对公司长期持续发展而言，厦门联芯折旧摊销影响合并口径利润只是暂时性因素，在折旧摊销完毕后公司盈利能力将非常可观。

厦门联芯12英寸工艺平台涵盖28nm、40nm、55nm、80nm等技术节点，拥有嵌入式非易失性存储、嵌入式高压、射频等多项特色工艺，可充分满足市场需求；且公司所处行业属于国家产业政策鼓励发展行业且具备良好的成长性。目前正在实施厦门联芯人工智能、5G等先进芯片技术研发及应用项目，其中计划结合发行人28HKMG工艺独创ReRAM芯片技术，并将其提升至22nm，在目前嵌入式非挥发性记忆体工艺中最具竞争力。目前已经研发完成28nm RF/mmWave特色工艺，达到国际先进水平。根据行业未来发展趋势以及对公司未来经营业绩的判断，公司具有良好的发展前景和持续盈利能力。

综上，公司具有持续的盈利能力。

## ③公司是否是真正拥有自主知识产权的产业化公司

公司针对自主研发的核心技术申请了专利保护，截止本补充法律意见书出具日，公司在国内外拥有发明专利71项，实用新型专利16项，集成电路布图设计12项，在国内拥有72项专利，其中发明专利57项，实用新型专利15项，在中国台湾地区拥有专利12项，其中发明专利11项，实用新型专利1项，在美国拥有3项发明专利。公司现有知识产权主要涵盖8英寸0.35 $\mu\text{m}$ 至0.11 $\mu\text{m}$ 等制程，公司已利用上述知识产权为量产多家客户定制化产品，公司母公司属于真正拥有知识产权的产业化公司。

公司子公司厦门联芯2016年11月建成投产，为快速提高我国12英寸芯片制造技术，降低研发失败风险，公司12英寸生产线28nm、40nm等先进制程技术主要来自控股股东联华电子授权，公司在引进吸收的基础上进行客制化、差异化研



发,已完全掌握了上述先进制程技术。公司在 12 英寸先进制程上取得的研发成果,目前正在申请相关的专利等知识产权,目前已经公布的进入实质审查阶段的发明专利有 7 项。根据联华电子出具的确认函,授权技术不存在纠纷或潜在纠纷,发行人拥有上述授权技术的使用权,权属清晰。

因此本所律师经核查认为发行人具备“研发-制造-销售”的一体化完备的产业链条,具备自我创新驱动发展的动能和持续的盈利能力,发行人合法拥有 8 英寸制程相关的专利等知识产权和 12 英寸技术的使用权,有多项已获得授权及正在申请的发明专利,属于真正拥有自主知识产权的产业化公司,符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法》“发行人业务完整,具有直接面向市场独立持续经营的能力”的要求。

#### **6、公司未对境外股权、业务进行重组的原因,有无将芯片相关核心技术及研发平台均从境外转移到发行人,以提高自主创新能力和独立性的方案;**

##### (1) 公司未对境外股权、业务进行重组的原因

①联华电子作为全球第三大晶圆代工企业,于 1985 年在台湾证券交易所上市,股票代码:2303,2000 年在纽约证券交易所挂牌上市(发行 ADR)。作为两地上市公司,联华电子要考虑保护自身股东利益,并受台湾地区和美国相关证券市场法律、法规的约束,公司如果要对其境外股权、业务进行重组,除了获得联华电子董事会、股东会审批,还需要取得台湾经济部投资审议委员会审批通过。同时根据台湾地区《大陆地区人民来台投资许可办法》和据此发布的《大陆地区人民来台投资业别项目》中规定,大陆企业来台投资“积体电路制造业”不得具有控制力。因此在目前芯片行业为敏感性行业的背景下,公司对境外股权、业务进行重组很难实现。

②除发行人和子公司厦门联芯从事晶圆制造相关业务外,公司最终控股股东联华电子及控制的其他企业中,与本公司业务存在相同或类似业务的公司情况如下:

序号	公司名称	注册地/生产经营地	持股比例	主营业务
1	联华电子	台湾新竹	-	晶圆制造
2	联华电子新加坡分公司	新加坡	属于联华电子的分公司	晶圆制造
3	联颖光电	台湾新竹	联华电子、宏诚投资合计持股 78.47%	晶圆制造,主要是 6 英寸砷化镓
4	美国联电	美国加利福尼亚	联华电子持股 100%	销售 IC
5	日本联电	日本东京	联华电子持股 100%	销售 IC

6	UNITED MICROELECTRONICS (EUROPE) B.V.	荷兰阿姆斯特丹	联华电子持股 100%	销售 IC
7	UMC KOREA CO., LTD.	韩国首尔	联华电子持股 100%	销售 IC
8	UMC TECHNOLOGY JAPAN CO., LTD.	日本东京	联华电子子公司 OMNI 持股 100%	半导体制造技术开发及顾问咨询服务

此外，联华电子持股 15.87% 的三重富士通的主营业务为晶圆制造，与本公司业务相同或类似。2018 年 6 月 29 日，联华电子公告将收购三重富士通的股权，收购完成后，联华电子将持有其 100% 的股权，三重富士通将成为联华电子的控制子公司。2018 年 12 月 19 日，联华电子公告收购三重富士通的股权交易已于 2018 年 9 月 26 日通过台湾主管机关核准，目前还尚待其他相关主管机关的核准。若未能在 2019 年 10 月 1 日完成交易，将因购买权过期而丧失全数购买三重富士通的权利。因为三重富士通正在收购过程中，公司不可能对其进行重组。

除发行人和发行人控制子公司厦门联芯从事晶圆制造业务外，联华电子其他制造业务主要分布在母公司、新加坡分公司和联颖光电，其中联颖光电是从事 6 英寸砷化镓晶圆制造，跟发行人生产工艺和应用领域有明显区别，其他晶圆厂由联华电子本部统一管理，业务不易分割，同时为了避免大额的关联交易，因此发行人未对境外业务、股权进行重组。

(2) 有无将芯片相关核心技术及研发平台均从境外转移到发行人，以提高自主创新能力和独立性的方案

厦门联芯通过在引进吸收基础上进行客制化、差异化研发，已掌握了联华电子授权的 28nm、40nm 等先进制程技术。并持续自主进行新的先进工艺研发，如 22nm 及嵌入式高压、嵌入式存储器等特色工艺开发等。

厦门联芯一直致力于建立自己的研发团队，截止 2018 年底，厦门联芯已有 140 名研发人员，来自世界各地，包括台湾和新加坡等地，目前仍在全球招募研发方面的人才。目前厦门联芯员工中从事 10 年以上半导体工作的员工超过 200 人。

厦门联芯以自有资金建立 12 英寸晶圆研发中心，专注于 12 英寸先进和特色工艺研发，不断提高自身创新能力。目前公司正大力研发人工智能、5G、物联网、无人驾驶等前沿芯片制造技术，2018 年 11 月 8 日，厦门联芯人工智能、5G 通讯等先进芯片技术研发及应用项目获“厦高管经备 2018544”号厦门市企业投资项目备案证明，发行人以自有资金投资先进技术研发项目。其中计划结合发行人 28HKMG 工艺独创 ReRAM 芯片技术，并将其提升至 22nm，在目前嵌入式非挥发性记忆体工艺中最具竞争力。目前已经研发完成 28nm RF/mmWave 特色工艺，达到国际先进水平。

公司部分核心机台具备生产更先进制程的能力，为公司研发更先进制程提供了相关的设备基础。

厦门联芯通过建立自己的研发团队、建立研发中心，并不断进行 28nm 以下更先进制程及特色工艺研发，提高自主创新能力和研发独立性。

本所律师经核查认为，联华电子作为全球第三代晶圆代工企业，在台湾证券交易所上市和纽约证券交易所挂牌上市（发行 ADR）。受台湾地区和美国相关证券市场法律、法规的约束，发行人如果要对其境外股权、业务进行重组，除了获得联华电子董事会、股东会审批，还需要取得台湾经济部投资审议委员会审批通过。在目前芯片行业为敏感性行业的背景下，发行人很难实现对境外股权、业务进行重组，在引进吸收基础上进行客制化、差异化研发，已掌握了联华电子授权的 28nm、40nm 等先进制程技术，发行人通过建立自己的研发团队、建立研发中心，并不断进行 28nm 以下更先进制程及特色工艺研发，提高自主创新能力和研发独立性。

**7、结合报告期内发行人通过联华电子及其关联方代销产品金额占收入总额的比例，说明在发行人对台湾地区、日本、北美洲等主要市场的销售要通过控股股东联华电子及其关联方进行的情况下，回复材料认为发行人拥有完整独立的销售服务体系是否符合企业实际情况；**

报告期内，发行人不存在通过联华电子及其关联方代销产品的情形。除在北美洲（主要是美国）、日本为经销外，发行人在中国大陆、台湾地区、新加坡、韩国、欧洲均为直销。

①发行人台湾地区的销售模式及销售金额

报告期内，发行人在台湾地区均为直销，发行人与台湾地区客户直接签署销售合同。联华电子利用其在台湾地区经营多年的形成的销售服务体系，仅为发行人提供营销支撑服务，包括市场商情收集；协助客户的接洽联系等，发行人向联华电子支付服务费。报告期内发行人在台湾地区的直销金额分别为 86,437.51 万元、118,578.26 万元、138,047.52 万元，占发行人营业收入的比例分别为 46.83%、36.64%、38.66%。

②在美国、日本的销售模式及销售金额

报告期内，发行人在美国、日本通过美国联电、日本联电经销，美国联电、日本联电获取销售差价。具体情况如下：

单位：万元

国家	2018 年		2017 年		2016 年	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例

美国	20,598.30	5.77%	9,833.24	3.04%	8,675.40	4.7%
日本	5,734.51	1.55%	4,556.96	1.44%	3,285.12	1.78%

### ③发行人已建立完整独立的销售服务体系

发行人主要从事晶圆代工业务，发行人主要客户是集成电路设计企业。发行人与联咏科技、矽力杰、联发科、紫光展锐等集成电路设计企业建立了长久的合作关系，与其在产品交货期、产品质量控制、技术保密、交货方式、付款方式等方面形成了标准化、系统化、合同化约束，从根本上保障产品的质量、交货时限等关键要素。客户根据生产计划以订单方式向发行人发出采购计划，发行人生产完成后发货完成销售。

发行人已建立完整独立的销售服务体系独立开拓客户。发行人由市场销售处负责公司产品的产销平衡、市场统筹等销售综合管理，市场销售处下设业务一部、业务二部、业务三部、新客户开发部、客户服务部。

发行人通过美国联电、日本联电经销主要是由于国内设计公司现状难以满足发行人先进制程产能需求，客观上发行人需要向美国、日本这样的芯片设计公司集中区域开发客户，以提高产能利用率，而美国联电、日本联电在美国、日本发展多年，在上述地区具有成熟的销售网络和服务体系，通过美国联电、日本联电向在美国、日本的客户销售产品并提供服务，可以保证对客户服务品质，有助于维系客户，具有商业交易的必要性及合理性。并且报告期内发行人在美国、日本晶圆销售收入占发行人销售收入比例较小，对发行人的影响不大。

综上所述，发行人在美国、日本主要采用经销的方式，中国大陆、台湾地区、新加坡、韩国、欧洲采用直销方式，不存在代销的情况；联华电子在台湾地区仅提供营销支持服务，发行人支付联华电子销售服务费；发行人通过美国联电、日本联电经销，主要是由于美国联电、日本联电在美国、日本具有成熟的销售网络和服务体系，通过两公司经销，可以保证服务质量；发行人市场销售处负责公司产品的产销平衡、市场统筹等销售综合管理，发行人已建立完整独立的销售服务体系，符合企业的实际情况。

**8、联华电子对下属晶圆制造厂与发行人在管理上的异同，发行人是否实质上属于联华电子的生产基地，在产供销和技术上对联华电子是否存在重大依赖，发行人是否具备独立经营和开拓市场的能力，是否构成本次发行上市障碍。**

除发行人和子公司厦门联芯从事晶圆制造相关业务外，联华电子本部管理着一座12寸厂，六座8寸厂，新加坡12寸厂是以联华电子分公司形式管理，联华电子控制子公司联颖光电管理一座6寸厂。联华电子本部和新加坡分公司晶圆厂采购、生产、销售均为联华电子统一管理，其实质上属于联华电子的生产车间。

联颖光电因为从事 6 英寸砷化镓晶圆制造，与联华电子其他晶圆厂主要原材料、生产工艺、应用领域等都有明显不同，因此拥有自己独立的研发、采购和销售体系，联华电子通过参与股东大会、委派董事、高管等方式对联颖光电进行管理；发行人是 2013 年被联华电子收购，被收购前已经建立了完整的研发、生产、采购、销售体系，被收购后发行人依然保持以前的产供销体系，发行人子公司厦门联芯 2016 年建成投产后，其实际经营管理和舰芯片负责。发行人已建立健全了股东大会、独立的董事会及下属专门委员会、监事会以及高级管理层等现代公司治理机制，决策公司的重大事项和日常生产经营管理。因此，发行人独立决策公司的研发、生产、采购、销售活动，在产供销上对联华电子不存在重大依赖，实质上不属于联华电子的生产基地。

发行人通过长期自主研发形成了自己具有知识产权的 8 英寸核心技术体系，通过在引进吸收联华电子先进的 28nm、40nm 等先进制程技术基础上，进行客制化和差异化研发，形成了自己 12 英寸核心技术体系，对联华电子已不存在重大技术依赖。

本所律师经核查认为，发行人已独立完整的拥有晶圆制造业务相关的研发、生产、采购、销售体系，与联华电子本部及新加坡分公司下属晶圆制造厂作为生产车间管理不同，与联华电子对联颖光电 6 英寸砷化镓晶圆厂管理方式类似，发行人实质上不属于联华电子的生产基地，在产供销和技术上对联华电子不存在重大依赖，发行人具备独立经营和开拓市场的能力，不构成本次发行上市障碍。

**9、请发行人说明，若不能取得联华电子的技术授权，对发行人生产经营的具体影响，并结合该影响说明是否对联华电子存在技术依赖。**

(1) 假设到期后不能继续取得授权技术，对发行人生产经营的具体影响

发行人控股股东授权技术到期后需要台湾经济部投资审议委员会核准。根据台湾地区目前的相关政策，在满足《作业要点》要求下技术授权批复不存在障碍，控股股东联华电子授权发行人 0.13 μm 技术到期后已于 2018 年 7 月成功免费续展。若不能取得联华电子的技术授权，对发行人影响分析如下：

A、联华电子授权厦门联芯制程技术是完整技术，包含制程技术、设计规则、电路布线、光罩图形档案、光罩等技术等。发行人通过在引进吸收的基础上进行客制化和差异化研究，已经完全掌握控股股东授权技术，继续获得授权只是为了避免知识产权方面的纠纷。发行人将以自有资金建立 12 英寸晶圆研发中心，专注于 12 英寸先进和特色工艺研发，不断提高自身创新能力。目前公司正大力研发人工智能、5G、物联网、无人驾驶等前沿芯片制造技术，满足国内客户对 5G、人工智能、物联网、无人驾驶等方面芯片需求。

B、联华电子拥有上述知识产权相关的专利权、营业秘密、集成电路布局权及

其他相关知识产权，并将其授权给发行人使用。因为公司并不拥有上述授权技术的知识产权，集成电路制造技术极其复杂，各个主要厂商使用的技术难免有相同或相似环节，因此第三方可能会以侵犯专利权或其他知识产权为由起诉发行人。如果发行人使用上述授权技术引致第三方以侵害其专利权或其他知识产权为由起诉发行人，联华电子将赔偿发行人因此所支付的律师费、诉讼费用、损害赔偿金及发行人因此所受的直接损害。

C、联华电子已出具确认函，联华电子授权和舰芯片、厦门联芯使用的授权技术到期后和舰芯片、厦门联芯可继续使用，联华电子不采取任何方式阻止或阻挠和舰芯片、厦门联芯继续使用，亦不在任何地方或区域对和舰芯片、厦门联芯提起诉讼或提起仲裁。因此即便到期后如果无法取得台湾经济部投资审议委员会核准或者联华电子授权，也不会对发行人产生重大不利影响。

因此，发行人对联华电子技术不存在重大依赖。

(2) 假设首次不能取得技术授权，对发行人生产经营的具体影响

控股股东授权技术主要集中在 12 英寸，涉及 28nm、40/55nm、80/90nm 制程技术。控股股东 8 英寸授权技术涉及制程为 0.11  $\mu\text{m}$  逻辑、0.11  $\mu\text{m}$  混合信号工艺、0.11  $\mu\text{m}$  至 0.13  $\mu\text{m}$  eFlash 和 0.11  $\mu\text{m}$  BCD 工艺四个制程，其中 0.11  $\mu\text{m}$  至 0.13  $\mu\text{m}$  eFlash 和 0.11  $\mu\text{m}$  BCD 工艺实际中并没有使用。假设首次就没有 12 英寸技术授权，发行人不会投资兴建厦门联芯，对发行人生产经营的具体影响如下：

A、发行人控股股东授权 8 英寸技术对发行人收入和毛利影响较小

单位：万元

项目		2018 年		2017 年		2016 年	
		收入	占比	收入	占比	收入	占比
8 英寸	自主技术	218,833.11	98.52%	207,561.46	98.29%	171,839.64	97.99%
	授权技术	3,297.70	1.48%	3,609.15	1.71%	3,524.04	2.01%
合计		222,130.81	100%	211,170.61	100%	175,363.69	100%
项目		2018 年		2017 年		2016 年	
		毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比
8 英寸	自主技术	70,112.00	98.14%	69,028.09	97.71%	47,067.36	97.00%
	授权技术	1,328.93	1.86%	1,615.84	2.29%	1,453.66	3.00%
合计		71,440.93	100%	70,643.94	100%	48,521.02	100%

报告期公司 8 英寸授权技术带来的收入分别为 3,524.04 万元、3,609.15 万元和 3,297.70 万元，占 8 英寸收入的比重分别为 2.01%、1.71%和 1.48%，8 英寸授权技术带来的毛利分别为 1,453.66 万元、1,615.84 万元和 1,328.93 万元，占 8 英寸毛利的比重为 3.00%、2.29%和 1.86%，8 英寸授权技术贡献的收入和毛利占

公司 8 英寸收入和毛利比重较小，因此 8 英寸技术对控股股东不存在重大依赖。

B、公司母公司净利润分别为 28,531.52 万元、40,768.95 万元和 50,939.88 万元，公司母公司盈利能力持续增长，年复合增长率达到 33.62%。

假设首次没有控股股东 12 英寸技术授权，发行人不会投资兴建 12 英寸生产线，经营业绩不会受 12 英寸生产线巨大的折旧、摊销的影响。发行人将会有较强的持续盈利能力。

C、公司在 8 英寸上积累了多年的研发经验，已经自主开发出 0.11  $\mu\text{m}$  嵌入式 pFlash 低功耗工艺平台、0.11  $\mu\text{m}$  嵌入式 pFlash 超低功耗工艺平台、0.11  $\mu\text{m}$  嵌入式 EEPROM 低功耗工艺平台等 8 英寸先进和特色制程工艺，另外发行人还独自开发出 0.18  $\mu\text{m}$  低导通电阻 BCD 工艺。上述 8 英寸特色工艺为发行人独有，与控股股东授权的 8 英寸技术形成明显的差异化优势。

本所律师经核查认为：（1）发行人授权技术到期后不能取得授权的可能性很小，发行人已经完全掌握相关授权技术，到期后继续续展只是为了避免第三方知识产权方面的纠纷。即使无法取得相关续展也不会对发行人产生重大影响。发行人对联华电子不存在重大依赖。（2）如果不能取得技术授权，发行人不会投资兴建 12 英寸生产线，经营业绩不会受 12 英寸生产线巨大的折旧和摊销的影响，报告期发行人将会有较强的持续盈利能力；发行人首次不能获得技术授权，因为授权技术主要是 12 英寸，8 英寸授权技术对发行人收入和毛利影响较小，因此发行人对授权技术不存在重大依赖。

### 三、《问询函》3. 关于控制厦门联芯以及将厦门联芯纳入合并报表范围

招股说明书及问询回复中披露了以下事项：（1）厦门金圆、福建电子创业投资所持厦门联芯股权的回购义务由联华电子或通过其子公司联华微芯履行，回购义务不涉及发行人及其子公司厦门联芯；（2）发行人拟尽快将产能提高到 5 万片/月，通过规模效应降低单位成本，早日实现扭亏为盈，而 5 万片完全达产预计还需要投资生产设备约 155 亿人民币；（3）联华电子出具确认函：确认联华微芯作为厦门联芯的股东，其表决权不可撤销地全权委托发行人行使；（4）董事会是厦门联芯的最高权力机构，决定厦门联芯的一切重大问题，厦门联芯董事会一共 9 名董事，其中三分之二由发行人委派，故发行人能控制厦门联芯董事会，报告期内，发行人委派至厦门联芯的董事包括：尤朝生、简山杰、林俊宏、王文杰、廖木良（2017 年 2 月离任）、陈进双、许志清、黄柏文（2018 年 11 月离任）八人。根据联华电子在台湾证券交易所披露的股东会年报显示，除尤朝生之外，其余 7 人都在联华电子或其关联方任职。

请发行人披露：（1）对厦门联芯达到满产 5 万片/月需要增加的约 155 亿投资资金来源及预计投资的具体时间安排，追加设备投资后预计产生的折旧摊销

情况，并量化分析对发行人未来业绩的具体影响；（2）需要追加的 155 亿资金投入是否由联华电子对厦门联芯进一步追加，发行人在厦门联芯的股权比例是否会因此被进一步稀释，是否会影响厦门联芯的生产经营决策机制；（3）联华电子或联华微芯对厦门金圆、福建电子创业投资所持厦门联芯股权的回购义务预计完成时间，回购完成后厦门联芯的股权结构，并结合回购完成后的联华电子持股比例进一步提高的情况，说明联华电子对厦门联芯的控制力是否将进一步增强；（4）厦门联芯的进一步投资是否依赖联华电子的资金投入，并结合厦门联芯主要制程技术都来源于联华电子授权的情况，分析并披露厦门联芯是否依赖于联华电子；结合芯片制造为资金和技术密集型的行业、联华电子内部对发行人以及厦门联芯具体管理方式，分析并披露发行人在厦门联芯生产经营中所起的作用，以及是否为关键作用，是否能主导厦门联芯的生产经营决策，发行人是否作为联华电子的代理或授权代理，管理厦门联芯，发行人在厦门联芯承担的责任与最终可以取得的收益是否能够匹配；（5）报告期内，简山杰、林俊宏、王文杰、廖木良（2017 年 2 月离任）、陈进双、许志清、黄柏文（2018 年 11 月离任）七人在联华电子及其关联公司内的具体任职和领薪情况；（6）发行人对厦门联芯派驻董事人选如何确定，是否出于联华电子的授意，发行人在厦门联芯委派董事是否为名义由其委派，实际由联华电子或其关联方委派或控制，请补充提供相关内部决策文件；结合派驻在厦门联芯的 6 名董事中的 5 名都主要在联华电子任职并领薪，特别是部分董事在联华电子内部的职级明显高于发行人委派至厦门联芯董事长尤朝生的情况，分析发行人如何能实质上控制厦门联芯的董事会；（7）结合联华电子将表决权不可撤销的委托给发行人，但实际派驻厦门联芯的董事主要为联华电子员工的情形，分析相关授权的实际执行情况；（8）结合以上事项以及《企业会计准则》中关于控制的定义，说明公司将厦门联芯纳入合并报表范围是否符合《企业会计准则》的要求。

请发行人律师结合上述情况，对发行人是否对厦门联芯构成控制发表明确意见，如认为控制，请提供类似案例等充分证据证明。

#### 回复：

本所律师取得了厦门联芯的工商档案资料、厦门联芯现行《章程》、厦门联芯报告期内的董事会决议、联华电子签署的《确认函》等文件、取得了简山杰、陈进双、林俊宏、王文杰、尤朝生、高明正、林伟圣尽职调查表或相关说明、厦门联芯财务、采购等部门负责人在和舰芯片任职和领薪的资料等，本所律师对相关人员的访谈，查阅了联华电子的年报，经核查如下：

（一）厦门联芯的进一步投资的 155 亿元主要依靠自有资金、银行借款、发行人和其他股东包括联华微芯的资本金的投入，其中发行人在厦门联芯的股



权比例不会被稀释,由于联华微芯将厦门联芯的表决权不可撤销的委托给发行人,发行人能够继续控制厦门联芯的董事会和生产经营,因此厦门联芯的生产经营决策机制不会受到影响。

(二)虽然联华电子回购厦门金圆、福建电子创业投资持有厦门联芯的股权后,联华电子持有厦门联芯的股权比例进一步提高,但联华电子已将表决权不可撤销委托给和舰芯片,并且厦门联芯的董事仍由和舰芯片委派,厦门联芯的经营管理权由和舰芯片控制,和舰芯片仍控制厦门联芯。

(三)厦门联芯的进一步投资的 155 亿元主要依靠自有资金、银行借款、发行人和其他股东包括联华微芯的资本金的投入,厦门联芯的进一步投资来源主要不是联华电子的资本金投入;厦门联芯已完全掌握厦门联芯授权的最先进制程技术,完全可以满足现阶段生产经营的需要,已对联华电子的技术不存在重大依赖。

(四)报告期内,谈文毅一直担任厦门联芯的总经理;报告期初至 2017 年 1 月,厦门联芯的财务负责人为林荣常,2017 年 2 月至今,厦门联芯的财务负责人为朱伟杰,上述三人均为发行人委派。而根据公司章程的规定,总经理负责厦门联芯的日常经营管理,厦门联芯的管理团队向总经理汇报,并在总经理监督及指示下制定管理制度。厦门联芯设立以来未设置专门的销售部门,其销售完全由发行人负责,人力、采购、环安、厂务、财务等部门负责人均由发行人委派。因此发行人能够在厦门联芯的生产经营中起关键作用,能够主导厦门联芯的经营及财务决策等。发行人能够控制厦门联芯董事会及经营管理团队,自主决定厦门联芯重大经营活动及财务决策,发行人作为联华电子控股子公司其利益与联华电子一致,符合股东利益最大化原则。发行人作为联华电子的子公司统一经营管理联华电子在中国大陆芯片制造产业,属于实质管理,不属于代理人角色。

发行人对厦门联芯拥有超过半数以上的表决权,能够通过董事会和实际经营管理的影响获取相应的回报,并且有能力运用对厦门联芯的权力影响其回报金额,发行人借助其他股东资金实力按照发行人的战略规划使厦门联芯做大做强,提高自身的市场影响力并从中获益。根据厦门联芯《公司章程》、《合资合营合同》,各股东遵循“利益共享、风险共担”的原则,发行人按照持股比例享受厦门联芯投资收益与承担相应的投资风险。

(五)发行人派驻厦门联芯的 6 名董事中,厦门联芯有 3 名董事在发行人处任职,其中尤朝生任副董事长兼财务负责人,林俊宏自 2018 年 6 月在发行人担任董事,王文杰自 2009 年起至今均在发行人处任监事。为进一步优化厦门联芯董事会结构,2019 年 5 月 21 日,发行人将向厦门联芯委

派的董事由简山杰、陈进双变更为高明正、林伟圣，高明正为发行人董事、总经理，林伟圣为发行人副总经理。

发行人负责联华电子在大陆地区晶圆代工业务的统一管理，发行人委派至厦门联芯的董事无论其任职在联华电子或者和舰芯片，均有共同的利益诉求，其在联华电子体系内职位的高低不影响其在董事会中代表和舰芯片的利益，均符合委派人和舰芯片的最终利益诉求。发行人派驻厦门联芯的部分董事在联华电子内部的职级虽然高于发行人委派至厦门联芯董事长尤朝生，但董事对公司重大经营事项的决策是通过董事会行使职权得以实现的，其职权是董事会的集体权力，不属于个别董事，这部分董事均由发行人委派，在厦门联芯召开董事会对相关事项进行表决时，这部分董事均以发行人的意思为准，均是代表发行人的利益，与联华电子的最终利益不会产生冲突。因此发行人对厦门联芯的董事会进行实质控制。

（六）联华电子将表决权不可撤销的委托给发行人的事项，已在《公司章程》、《合营合同》予以体现，厦门联芯的董事会中原由联华微芯指派的两席董事，改由发行人指派，并且上述情况经厦门联芯商务主管部门、工商主管部门审批或备案，自联华电子委托表决权以来，即使发行人派驻的董事主要为联华电子员工，但在厦门联芯的历次董事会上均以发行人的意思为准，代表发行人的利益并且一致表决，厦门联芯的总经理、财务负责人和销售人力、采购、环安、厂务等部分的负责人均由和舰芯片委派。相关授权实际执行情况有效并且良好，和舰芯片能够对厦门联芯进行控制。

结合上述情况，本所律师核查分析如下：

1、2013年2月联华电子取得和舰有限控制权后，为发挥和舰有限在大陆经营管理优势，统一经营管理联华电子在中国大陆芯片制造产业。2015年2月和舰有限出资控股厦门联芯。考虑地方政府对外商投资的政策支持，且因为12英寸晶圆厂投资太大，2017年1月和12月发行人将厦门联芯50.7246%出资权转让给联华电子全资孙公司联华微芯，发行人借助联华电子的资金实力对厦门联芯进行投资，2018年7月联华电子确认，在厦门联芯历次股东会上对相关事项的表决中，联华电子（透过联华微芯）与发行人采取了一致行动，且以发行人的意思表示为准，联华微芯将表决权不可撤销地全权委托发行人行使，因此，和舰芯片自2015年2月对厦门联芯出资以来，从表决权上对厦门联芯一直具有控制权。上述表决权不可撤销地全权委托发行人行使，发行人作为联华电子的子公司，发行人控制厦门联芯与联华电子的实际利益一致，联华电子通过控制发行人的相关决策过程，完全能够达到控制厦门联芯。

2、发行人负责联华电子在大陆地区晶圆代工业务的统一管理，发行人委派至厦门联芯的董事无论其任职在联华电子或者和舰芯片，均有共同的利益诉求，其在联华电子体系内职位的高低不影响其在董事会中代表和舰芯片的利益，均符合委派人和舰芯片的最终利益诉求。发行人派驻厦门联芯的部分董事在联华电子内部的职级虽然高于发行人委派至厦门联芯董事长尤朝生，但董事对公司重大经营事项的决策是通过董事会行使职权得以实现的，其职权是董事会的集体权力，不属于个别董事，这部分董事均由发行人委派，在厦门联芯召开董事会对相关事项进行表决时，这部分董事均以发行人的意思为准，均是代表发行人的利益，与联华电子的最终利益不会产生冲突。且发行人副董事长一直兼任厦门联芯董事长，因此发行人能够通过控制厦门联芯的董事会对厦门联芯进行控制。

3、发行人副董事长兼财务负责人尤朝生先生一直兼任厦门联芯董事长，厦门联芯总经理、财务负责人等高管以及主要部门负责人均由发行人委派，实际负责厦门联芯的运营，主导厦门联芯的商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置以及融资活动等。

4、通过对董事会和实际经营管理的影响获取相应的回报，即发行人有能力运用对厦门联芯的权力影响其回报金额。

5、联华电子或联华微芯完成对厦门金圆、福建电子创业投资所持厦门联芯股权的回购义务后虽然联华电子持有厦门联芯的股权比例进一步提高，但联华电子已将表决权委托给和舰芯片，并且厦门联芯的董事仍由和舰芯片委派，厦门联芯的经营管理权由和舰芯片控制，和舰芯片仍控制厦门联芯。

6、从厦门联芯的进一步投资和制程技术来看，厦门联芯对联华电子不存在重大依赖。和舰芯片通过控制厦门联芯董事会及经营管理团队，能够自主决定厦门联芯重大经营活动及财务决策，其利益与联华电子一致，符合股东利益最大化原则。发行人作为联华电子的子公司统一经营管理联华电子在中国大陆芯片制造产业，不属于代理人角色。

7、根据本所律师搜寻相关上市公司信息披露文件，与发行人控制厦门联芯类似的相关案例如下：

(1) 广州酒家（603034）控制公益路公司

公益路餐饮有限公司大股东广东湖景金阁饮食有限公司持股比例为42%，二股东广州酒家虽持有公益路餐饮有限公司41%的股权，但在董事会占多数席位，且董事长、总经理和财务负责人皆由广州酒家提名委派，故广州酒家将该公司纳入合并范围。

(2) 中曼石油（603619）控制阿布扎比公司

截至 2018 年 12 月 31 日，TFAMS 持有阿布扎比公司 51% 股权，中曼石油持有阿布扎比公司 49% 股权。根据该公司章程与协议约定，中曼石油拥有阿布扎比公司的控制权。中曼石油将该公司纳入合并范围。

(3) 韦尔股份（603501）控制无锡中普微

2014 年 9 月 29 日，韦尔股份与无锡中普微股东签署的《增资协议书》，韦尔股份收购无锡中普微 25% 股权（董事会表决权 60%）并对其构成控制，购买日为 2015 年 1 月 13 日。无锡中普微二股东持股比例为 21.87%，三股东持股比例为 19.05%。自 2015 年 1 月 13 日起韦尔股份将无锡中普微及其子公司安浦利纳入合并范围。

综上，和舰芯片自 2015 年 2 月以来从表决权上对厦门联芯一直具有控制权，通过委派董事或者总经理、财务负责人等，控制董事会及经营管理团队，能够自主决定厦门联芯重大经营活动及财务决策，其利益与联华电子一致，符合股东利益最大化原则并结合相关案例，本所律师认为，发行人对厦门联芯构成控制，证据充分。

**请保荐机构、发行人律师对厦门联芯董事会成员是否主要由发行人委派进行核查，说明核查手段、核查方式，是否做到勤勉尽责。**

**回复：**

本所律师会同保荐机构履行了如下核查手段、方式

(1) 取得了厦门联芯工商档案资料及工商年检资料并登陆国家企业信用信息公示系统查询；

(2) 取得了厦门联芯现行生效的公司章程、《合资合营合同》；

(3) 取得了简山杰、陈进双、林俊宏、王文杰、尤朝生、、高明正、林伟圣签署的调查表及联华电子出具的相关说明；

(4) 取得了发行人向厦门联芯出具的董事委派书；

(5) 取得了联华微芯向厦门联芯出具的董事委派书；

(6) 取得了发行人将派驻厦门联芯的董事由黄柏文改为林俊宏时履行的内部核决程序文件；

(7) 对简山杰、林俊宏、王文杰、廖木良、陈进双、许志清、黄柏文、尤朝生、高明正、林伟圣等人进行了访谈；

(8) 取得了发行人将派驻厦门联芯的董事简山杰、陈进双变更为高明正、林伟圣履行的内部核决程序文件；

(9) 取得了联华电子出具的发行人对厦门联芯控制的《确认函》。

经核查如下：

报告期内，尤朝生、黄柏文（2018年11月离任）、林俊宏、王文杰、廖木良（2017年2月离任）、简山杰作为厦门联芯的董事由发行人委派，发行人向厦门联芯出具了董事委派书。陈进双、许志清作为厦门联芯的董事，2017年1月至2018年7月由联华微芯委派，2016年1月至2017年1月期间及2018年7月后由和舰芯片委派并由和舰芯片出具董事委派书。2019年5月21日，和舰芯片委派董事由简山杰、陈进双改为高明正、林伟圣，和舰芯片出具了董事委派书。

为保障联华电子透过联华微芯与发行人采取一致行动，联华电子出具了《确认函》，主要内容如下：

“（1）为发挥发行人在大陆经营管理优势，自发行人对厦门联芯出资以来，厦门联芯均由发行人实际控制，厦门联芯的采购、生产、销售、技术、财务决策方面均由发行人管理；自发行人对厦门联芯出资以来，厦门联芯的董事会席位九名，其中，四名董事会成员由发行人委派，两名董事会成员由联华电子（透过联华微芯）委派，其他三名董事会成员由大陆方股东委派。厦门联芯董事长由发行人委派的董事出任，厦门联芯的财务负责人亦由发行人委派的人选出任。（2）在厦门联芯的重大事项的决策上，联华电子（透过联华微芯）委派的董事与发行人委派的董事均事先进行了充分沟通与协商，联华电子（透过联华微芯）委派的董事与发行人委派的董事采取了一致行动并以发行人委派的董事的意思表示为准；联华电子（透过联华微芯）作为厦门联芯的股东，在厦门联芯股东会上，联华电子（透过联华微芯）与发行人采取了一致行动，且以发行人的意思表示为准。（3）在厦门联芯现有股权结构下，为维持上述控制关系，联华电子（透过联华微芯）向厦门联芯委派的董事今后改由发行人委派，联华微芯作为厦门联芯的股东，其表决权不可撤销地全权委托发行人行使。（4）在厦门联芯现有股权结构下，厦门联芯董事长、财务负责人等人员持续由发行人委派，厦门联芯持续为发行人控制的子公司。联华电子同意厦门联芯依据上述确认的内容相应修改其章程对应条款”。

2018年7月24日，厦门联芯召开董事会，同意对《厦门联芯章程》、《合资合营合同》予以修订，新增、修订的内容如下：A、原由联华微芯指派的两席董事，改由发行人指派。B、原规定由发行人或联华微芯指派的一席监事，改由发行人指派。此外《合资合营合同》还增加“厦门联芯存续期间，若涉及股东行使表决权的事项，如增资、减资、修改厦门联芯章程、变更公司组织形式或厦门联芯运营中涉及的重大事项等，联华微芯作为厦门联芯的股东，其表决权不可撤销的全权委托给发行人行使”的内容。《厦门联芯章程》、《合资合营合同》的上述

修订已报厦门联芯商务主管部门、工商主管部门审批或备案。

发行人向厦门联芯派驻董事，均由发行人向厦门联芯出具了董事委派书。在股份公司设立之前，发行人对于派驻厦门联芯的董事并未履行内部的决策文件。在股份公司成立之后，公司法人治理结构和内部控制制度得到进一步完善，2018年11月，发行人将派驻厦门联芯的董事由黄柏文改为林俊宏时履行了内部的核决程序，发行人向厦门联芯出具了董事委派书。

发行人为进一步加强对厦门联芯董事会的控制，2019年5月21日，发行人完成内部核决程序，将派驻厦门联芯的董事简山杰、陈进双变更为高明正、林伟圣，本次变更董事还需要厦门联芯董事会的审议通过和工商局的备案。

综上，本所律师认为，厦门联芯董事会成员主要由发行人委派，本所律师已做到勤勉尽责。

#### 四、《问询函》4. 关于厦门联芯回购条款

根据问询回复，厦门金圆、福建电子创业投资所持厦门联芯股权的回购由联华电子或通过其子公司联华微芯履行，回购方式为出资额加计固定收益，联华微芯、和舰有限、厦门金圆、福建电子创业投资四方于2016年12月12日签署的《合资合营合同》显示，回购义务由“联华微芯/发行人”完成。

请发行人说明：（1）上述股份回购事宜是厦门金圆、福建电子创业投资的权利还是义务，到期后能否选择继续持有；（2）在到期后以固定收益进行回购的情形下，不认定厦门金圆、福建电子创业投资所持厦门联芯股权属于“明股实债”的原因及合理性；（3）结合厦门联芯股份回购条款，说明在《合资合营合同》、《厦门联芯章程》未对盈亏承担予以具体约定的情况下，由四方股东按照比例进行分红或承担亏损是否符合“利益共享，风险共担”的原则，股东的权利和义务是否对等；（4）上述股份回购条款的约定是否经过了国资审批程序，是否可能会造成国有资产流失；

请保荐机构、发行人律师对上述事项（1）至（4）进行核查，并发表明确意见。

#### 回复：

本所律师取得了厦门联芯的工商档案资料、登入“国家企业信用信息公示系统”对厦门金圆、福建电子创业投资工商登记信息予以查询，取得厦门市人民政府、联华电子、福建省电子集团于2014年签订的《参股协议书》，取得了和舰有限、联华微芯、厦门金圆、福建电子集团四方于2016年12月签署的《合资合营合同》、《厦门联芯章程》，并取得相关各方于2018年7月修订的《合资合营合

同》、《厦门联芯章程》，查阅了外商投资、金融监管有关的法律法规，经核查如下：

**1、上述股份回购事宜是厦门金圆、福建电子创业投资的权利还是义务，到期后能否选择继续持有；**

厦门市人民政府、联华电子、福建省电子集团于 2014 年签订的《参股协议书》，约定从厦门市人民币政府和福建省电子集团全部资本金到位第 7 年开始，联华电子按照 60%、20%、20%的比例分三次在连续三年内完成回购其所持厦门联芯股权，如果届时台湾地区法律仍然规定联华电子不能在大陆独资经营，则福建省电子集团可以保留厦门市人民政府、福建省电子集团合计 10%资本金不回购。回购价格以实际投入资本金加 10%的固定收益。和舰有限、联华微芯、厦门金圆、福建电子集团四方于 2016 年 12 月签署的《合资合营合同》约定，厦门金圆、福建电子集团出资的资本金，从其资本金到账后第 7 年开始，由发行人/联华微芯按 60%、20%、20%的比例分三次在连续三年完成全部回购。如果届时台湾地区仍然规定发行人/联华微芯不能在大陆地区独资经营，则发行人/联华微芯可以选择由厦门金圆、福建电子集团继续持有厦门联芯合计 10%的注册资本（资本金），即对该 10%的注册资本（资本金）不予回购。回购价格为厦门金圆、福建电子集团实际投入的资本金加 10%的固定收益。

参考财政部财预〔2015〕210 号《关于印发〈政府投资基金暂行管理办法〉的通知》（2015 年 11 月 12 日施行）的规定，厦门金圆、福建电子创业投资属于政府主导设立的引导社会各类资本投资经济社会发展的重点领域和薄弱环节、支持相关产业和领域发展的政府投资基金。《参股协议书》、《合资合营合同》约定的对厦门金圆、福建电子创业投资所持厦门联芯股权的回购条款为国有股东为防止国有资产流失设置的未来股权安排。《合资合营合同》为厦门联芯股东的真实意思表示、履行了各自必要的决策程序且已经当地工商主管部门、商务主管部门备案或批准，上述股份回购事宜为厦门金圆、福建电子创业投资的权利。

上述回购条款的设置，不存在侵害厦门联芯利益的情形，亦不属于厦门联芯作为法人主体承担的义务，联华电子已出具承诺，为能够促进和舰芯片稳定及可持续盈利能力，在满足台湾、中国大陆法律、政策允许并能够取得相关主管部门核准且和舰芯片能够控制厦门联芯的情形下，上述《合资合营合同》及厦门联芯现有有效的文件中约定的对厦门金圆、福建电子创业投资所持厦门联芯的股权回购义务由联华电子本部或联华电子下属子公司联华微芯亲自承担。联华电子上述承诺已取得厦门金圆、福建电子创业投资的书面确认。因此，上述股份回购事宜属于联华电子本部或联华电子下属子公司联华微芯的义务。就国有资产增值保值而言，上述股份回购事宜为厦门金圆、福建电子创业投资的权利。

和舰有限、联华微芯、厦门金圆、福建电子集团四方于 2016 年 12 月签署的《合资合营合同》关于“如果届时台湾地区仍然规定发行人/联华微芯不能在大陆地区独资经营，则发行人/联华微芯可以选择由厦门金圆、福建电子集团继续持有厦门联芯合计 10%的注册资本（资本金），即对该 10%的注册资本（资本金）不予回购”。根据上述规定，若届时仍然规定发行人/联华微芯不能在大陆地区独资经营，厦门金圆、福建电子创业投资可合计持有厦门联芯 10%的股权。依据《中华人民共和国合同法》的规定，届时，厦门联芯各方股东若能够达成一致且取得各自有权决策机构审批及相关主管部门批准的情况下，厦门金圆、福建电子创业投资所持厦门联芯的全部或部分股权到期后能够选择继续持有。

本所律师经核查认为，上述股份回购事宜为厦门金圆、福建电子创业投资的权利，根据厦门联芯《公司章程》、《合资合营合同》等规定，如果到期后台湾地区规定发行人/联华微芯不能在大陆独资经营，则发行人/联华微芯可以选择由厦门金圆、福建电子集团继续持有厦门联芯合计 10%的注册资本（资本金），即对该 10%的注册资本（资本金）不予回购。依据《中华人民共和国合同法》的规定，届时，厦门联芯各方股东若能够达成一致且取得各自有权决策机构审批及相关主管部门批准的情况下，厦门金圆、福建电子创业投资所持厦门联芯的全部或部分股权到期后能够选择继续持有。

## **2、在到期后以固定收益进行回购的情形下，不认定厦门金圆、福建电子创业投资所持厦门联芯股权属于“明股实债”的原因及合理性；**

（1）回购条款的设置，不存在侵害厦门联芯利益的情形，亦不属于厦门联芯作为法人主体承担的义务，根据联华电子已出具的承诺，上述股份回购事宜属于联华电子本部或联华电子下属子公司联华微芯的义务，联华电子出具的上述承诺已取得厦门金圆、福建电子创业投资的书面确认。因此，就国有资产增值保值而言，上述股份回购事宜为厦门金圆、福建电子创业投资的权利。依据《中华人民共和国合同法》的规定，届时，厦门联芯各方股东若能够达成一致且取得各自有权决策机构审批及相关主管部门批准的情况下，厦门金圆、福建电子创业投资所持厦门联芯的全部或部分股权到期后能够选择继续持有。

（2）厦门联芯为中外合资有限责任公司，《参股协议书》、《合资合营合同》约定的对厦门金圆、福建电子创业投资所持厦门联芯股权的回购条款符合《公司法》针对有限责任公司股权转让关于“公司章程对股权转让另有规定的，从其规定”的规定。《合资合营合同》约定的对厦门金圆、福建电子创业投资所持厦门联芯股权的回购条款为国有股东为防止国有资产流失设置的未来股权安排。

（3）《合资合营合同》为厦门联芯股东的真实意思表示、履行了各自必要的决策程序且已经当地工商主管部门、商务主管部门备案或批准。



(4) 厦门联芯相关各方应按照出资比例进行分红或承担亏损

《参股协议书》、《合资合营合同》、《厦门联芯章程》虽未对盈亏承担予以具体约定，但确定了“利益共享，风险共担”原则，根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》（根据 2016 年 9 月 3 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议《关于修改〈中华人民共和国外资企业法〉等四部法律的决定》第三次修正）关于“合营企业的形式为有限责任公司。在合营企业的注册资本中，外国合营者的投资比例一般不低于百分之二十五。合营各方按注册资本比例分享利润和分担风险及亏损。合营者的注册资本如果转让必须经合营各方同意”规定，四方股东应按照出资比例进行分红或承担亏损，且依据《中华人民共和国中外合资经营企业法》上述规定，四方股东能够按照出资比例进行分红或承担亏损。

(5) 厦门联芯为中外合资企业，根据《中外合资经营企业法实施条例》、《厦门联芯章程》，董事会是厦门联芯的最高权力机构，决定厦门联芯的一切重大问题。依据《合资合营合同》、《厦门联芯章程》约定，厦门金圆、福建电子创业投资向厦门联芯委派了三名董事，实际参与了厦门联芯的重大经营决策。

(6) 我国未有法律法规及规范性文件对“明股实债”予以明确规定，针对《参股协议》、《合资合营合同》约定的对厦门金圆、福建电子创业投资所持厦门联芯股权的回购条款，根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》关于“合营各方按注册资本比例分享利润和分担风险及亏损”的规定且厦门联芯、福建电子创业投资以其所持股权通过委派董事参与了厦门联芯的重大经营决策并参照国家税务总局《关于企业混合性投资业务企业所得税处理问题的公告》（国家税务总局公告 2013 年第 41 号）关于“企业混合性投资业务，是指兼具权益和债权双重特性的投资业务”的规定，厦门金圆、福建电子创业投资所持厦门联芯股权不属于“明股实债”。

本所律师经核查后认为，在到期后以固定收益进行回购的情形下，不认定厦门金圆、福建电子创业投资所持厦门联芯股权属于“明股实债”合理。

**3、结合厦门联芯股份回购条款，说明在《合资合营合同》、《厦门联芯章程》未对盈亏承担予以具体约定的情况下，由四方股东按照比例进行分红或承担亏损是否符合“利益共享，风险共担”的原则，股东的权利和义务是否对等；**

《合资合营合同》、《厦门联芯章程》虽未对盈亏承担予以具体约定，但确定了“利益共享，风险共担”原则，四方股东应按照出资比例进行分红或承担亏损符合《中华人民共和国中外合资经营企业法》（根据 2016 年 9 月 3 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议《关于修改〈中华人民共和国外资企业法〉等四部法律的决定》第三次修正）关于“合营企业的形式为有限责任公司。在合营企业的注册资本中，外国合营者的投资比例一般不低于百分之二十五。

合营各方按注册资本比例分享利润和分担风险及亏损。合营者的注册资本如果转让必须经合营各方同意”规定，且依据《中华人民共和国中外合资经营企业法》上述规定，四方股东能够按照出资比例进行分红或承担亏损。

本所律师经核查后认为，厦门联芯《合资合营合同》、《厦门联芯章程》虽未对盈亏承担予以具体约定的情况下，根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》“合营各方按注册资本比例分享利润和分担风险及亏损”相关规定，由四方股东按照比例进行分红或承担亏损符合“利益共享，风险共担”的原则，股东的权利和义务对等。

#### **4、上述股份回购条款的约定是否经过了国资审批程序，是否可能会造成国有资产流失；**

2016年12月，和舰有限、联华微芯、厦门金圆、福建电子集团签订《合资合营合同》并对回购条款予以约定，上述《合资合营合同》及回购条款的约定的依据为厦门市人民政府、联华电子、福建电子集团于2014年签署的编号为XMX2014100902《参股协议书》。

厦门金圆成立于2014年8月13日，厦门金圆投资集团有限公司现持有厦门金圆100%的股权，厦门市财政局现持有厦门金圆投资集团有限公司100%的股权。2014年9月30日，厦门市财政局批复由厦门金圆产业发展有限公司执行落实《参股协议书》。

2014年9月28日，福建电子集团作出董事会决议，同意根据省政府工作部署，由福建电子集团与厦门金圆先行设立厦门联芯，签署《参股协议书》。

2016年5月23日，福建电子集团与福建电子创业投资签署《股权转让协议》，福建电子集团将其持有厦门联芯5.314%的股权（认缴注册资本67,476.2万元，实缴出资18,744万元），以18,744万元的价格转让给福建电子创业投资，所转让的股权中尚未出资到位的48,732.2万元注册资本由福建电子创业投资按厦门联芯公司章程如期出资。2016年7月25日，福建省人民政府国有资产监督管理委员会作出闽国资函产权[2016]267号《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建省电子信息（集团）有限责任公司转让联芯集成电路制造（厦门）有限公司股权的函》，同意上述股权转让。

福建电子创业投资成立于2015年5月25日，其为福建省电子集团下属全资子公司，福建省人民政府国有资产监督管理委员会现持有福建省电子集团100%股权。福建省电子集团为福建省人民政府出资组建的电子行业国有独资资产经营公司和投资平台。

厦门金圆为厦门市财政局下属二级企业，厦门金圆参与投资厦门联芯时已取得厦门市财政局批准且《参股协议书》为厦门市人民政府直接签署，福建电子创

业投资为福建省电子集团下属全资子公司，福建电子集团将其所持厦门联芯股权转让予下属子公司已取得福建省人民政府国有资产监督管理委员会闽国资函产权[2016]267号文批准。福建电子集团与厦门金圆共同设立厦门联芯时，福建电子集团于2014年9月28日作出董事会决议，同意根据省政府工作部署，由福建电子集团与厦门金圆先行设立厦门联芯。

综上，本所律师核查后认为，上述股份回购条款的约定已经过了国资审批程序，不会造成国有资产流失。

#### **五、《问询函》6. 关于本次发行上市决策程序**

**发行人最终控股股东为台湾上市公司联华电子。请发行人说明披露公司选择大陆上市是否符合台湾地区证券监管法规要求，是否履行了相应的决策、信息披露程序。公司在大陆上市是否需要取得并已经取得了台湾地区陆委会的相关意见。**

**请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查，并发表明确意见。**

#### **回复：**

本所律师会同保荐机构通过查阅联华电子公开披露的信息、查阅中国台湾证券管理相关法规、询问联华电子相关信息披露人员、并取得（台湾）普华商务法律事务所出具的《查核法律意见书》、普字第19004017号《法律意见书》对发行人选择大陆上市是否符合台湾地区证券监管法规要求，是否履行了相应的决策、信息披露程序等事项进行了核查，具体情况如下：

中国台湾证券管理法律以《证券交易法》为主要依据，并授权台湾证券交易所股份有限公司（以下简称“台湾证券交易所”）订定《台湾证券交易所股份有限公司营业细则》（以下简称“《营业细则》”）暨各项准则，因此，中国台湾上市公司应遵守《证券交易法》、《营业细则》等相关法令规范。

依据（台湾）普华商务法律事务所出具的《查核法律意见书》，联华电子分拆和舰芯片在上海证券交易所上市，已依《营业细则》第48条之3第1项、《重大讯息处理程序》第4条第1项第50款、第51款规定，就本申请案经审计委员会、董事会、股东会决议及践行信息揭露义务，符合台湾证券法律法规、台湾证券交易所之相关规定，不存在纠纷或潜在纠纷，亦不因子公司海外挂牌上市而导致联华电子下市的情形。

就发行人本次发行上市事项，联华电子已于2018年6月29日召开董事会，审议通过发行人本次发行上市相关事项，2018年8月20日，联华电子召开2018年第一次股东临时会，审议通过发行人本次发行上市相关事项，且就发行人本次发行上市事项，已履行相关信息披露程序。

（台湾）普华商务法律事务所出具的普字第19004017号《法律意见书》，台

湾地区陆委会对台湾公司转投资之大陆公司于大陆地区申请首次公开发行股票及上市之限制规定，发行人在大陆上市无需取得台湾地区陆委会的相关意见。

本所律师核查后认为，发行人选择大陆上市符合中国台湾地区证券监管法规要求，履行了相应的决策、信息披露程序。发行人在大陆上市无需取得台湾地区陆委会的相关意见。

#### **六、《问询函》8. 关于未按期缴纳第一期出资事项**

**发行人前身和舰有限未在营业执照签发之日起 90 天内缴清第一期出资额。**

**请发行人结合当时有效的《中华人民共和国外资企业法实施细则》第三十条第二款规定，说明上述未按期缴付第一期出资是否会导致其外资企业批准证书即自动失效，如未自行办理注销登记，是否存在被工商行政管理机关吊销营业执照的风险。**

**请提供市场监督管理局出具的关于发行人外资企业批准证书未自动失效，且不存在被吊销风险的明确意见。**

**请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查，并发表明确意见。**

#### **回复：**

本所律师会同保荐机构通过取得发行人工商资料和历次出资验资报告、询问发行人相关人员、取得苏州工业园区市场监督管理局出具的守法证明、发行人出具的说明文件等方式对和舰有限首期出资情况进行了核查，具体情况如下：

和舰有限成立于 2001 年 11 月 23 日，其设立时注册资本为 3.5 亿美元，系由投资联盟独资设立的外商独资有限公司。2002 年 1 月 23 日，投资联盟向和舰有限缴纳 1,499,990 美元出资款。2002 年 3 月 20 日，苏州工业园区管理委员会出具苏园管复字[2002]24 号《关于和舰科技（苏州）有限公司变更投资方的批复》，同意和舰有限的投资方变更为橡木联合。和舰有限收到股东缴纳的第一期 6,000 万美元出资中有 1,499,990 美元系原股东投资联盟于 2001 年 1 月 23 日汇入和舰有限，另外 58,500,010 美元为橡木联合于 2002 年 4 月 23 日至 2002 年 11 月 26 日分七次汇入和舰有限。橡木联合对和舰有限设立时首期出资超过《外资企业法实施细则》（2001）和《关于设立外商独资“和舰科技（苏州）有限公司”的批复》所规定的“自营业执照签发之日 90 天内注入 15%”的期限。

和舰有限未按照营业执照签发之日起 90 天内缴清第一期出资额的 15% 事项不符合《中华人民共和国外资企业法实施细则》（根据 2001 年 4 月 12 日《国务院关于修改〈中华人民共和国外资企业法实施细则〉的决定》修订）第三十条的规定，但工商主管部门及商务审批部门当时未对和舰有限处以行政处罚。和舰有限股东

虽存在逾期出资的情形，但其采取实际出资的行为予以弥补，和舰有限其后多次增资事宜业经当地外商投资主管部门批复及工商登记主管机关变更登记，当地外商投资主管部门和工商登记主管机关未对其前期逾期出资的行为予以行政处罚，且苏州工业园区市场监督管理局证明，和舰芯片自设立以来未因违反工商行政方面法规被查处过，和舰有限不存在行政处罚的风险。

2019年5月17日，苏州工业园区市场监督管理局确认上述未按期缴付第一期出资未导致江苏省人民政府当时颁发的批准号为外经贸苏府资字[2001]36911号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》的自动失效和被撤销，截至目前，发行人合法有效存续，不存在被吊销营业执照的风险。

本所律师核查后认为，上述未按期缴付第一期出资未导致其外资企业批准证书即自动失效，和舰有限亦未自行办理注销登记，不存在被工商行政管理机关吊销营业执照的风险。

## **七、《问询函》10. 关于客户认证**

**公司主要客户是集成电路设计企业。公司与联咏科技、矽力杰、联发科、紫光展锐等集成电路设计企业建立了长久的合作关系。**

**请发行人说明是否取得了所有客户的认证或者准入，相关认证是否有期限、是否即将到期、有无到期续期不能的风险。**

**请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查，并发表明确意见。**

### **回复：**

#### **1、发行人本身不需要客户相关认证**

发行人主要从事晶圆代工业务，公司主要客户是集成电路设计企业，公司产品晶圆主要应用于通讯、计算机、消费电子、汽车电子等领域。

发行人的所有客户未直接向发行人及其子公司授予相关认证或准入，不需要取得客户颁发认证证书，但客户芯片产品量产前需要进行产品验证。

通常客户将就特定芯片产品与发行人就芯片制造工艺平台进行技术交流，客户结合发行人的芯片制造工艺特性进行研发设计集成电路布图，并委托发行人进行试生产少量晶圆并经封测厂封装工序后成为芯片成品，芯片成品经检测电路的功能性和可靠性等各项指标符合预定设计目标后，即完成了芯片产品量产前的验证工作。

#### **2、发行人取得的第三方认证情况**

和舰芯片通过了 ISO 14001 环境管理体系、IATF16949 汽车业管理体系等认证、ISO9001 质量管理体系、IECQ QC 080000 有害物质过程管理体系、ISO /IEC 27001 信息安全管理体系认证。

厦门联芯通过了 ISO 14001 环境管理体系、ISO9001 质量管理体系、ISO 45001 职业健康安全体系认证、IECQ QC 080000 有害物质过程管理体系、IATF16949 汽车业管理体系认证。

除 IATF16949 汽车业管理体系认证外，其他认证皆为通用性的管理体系认证，有助于发行人向所有客户证明其拥有卓越的质量控制能力。和舰芯片与厦门联芯皆通过的 IATF16949 汽车业管理体系认证属于汽车行业相关的认证。通过 IATF 16949 认证有助于发行人获取汽车电子领域的晶圆制造业务机会。

### 3、相关认证是否有期限、是否即将到期、有无到期续期不能的风险

发行人取得的认证具体情况如下：

证书名称	资质等级	发证机关	权属人	证书号	有效期
ISO 14001:2015	国际认证	DNV. GL	和舰芯片	1578-2004-AE-R GC-RvA	2019. 9. 24
IATF16949:2016 (含产品设计)	国际认证	DQS	和舰芯片	50050411IATF16	2021. 4. 11
ISO9001:2015	国际认证	DQS	和舰芯片	50050411QM15	2021. 4. 11
IECQ QC 080000:2012	国际认证	BSI	和舰芯片	IECQ-H BSI 14. 0005	2020. 4. 3
ISO /IEC 27001:2013 审 核证书	国际认证	BSI	和舰芯片	IS581023	2021. 8. 18
ISO 14001:2015	国际认证	SGS	厦门联芯	CN17/31382	2020. 10. 24
ISO 9001:2015	国际认证	DQS	厦门联芯	50600175 QM15	2021. 4. 24
ISO 45001: 2018	国际认证	SGS	厦门联芯	CN17/31767	2020. 12. 7
IECQ QC 080000:2017	国际认证	DQS	厦门联芯	IECQ-H ULTW 18. 0004	2021. 4. 29
IATF16949:2016 (含产品设计)	国际认证	DQS	厦门联芯	50600175 IATF16	2021. 4. 24

未来六个月内，和舰芯片的 ISO 14001:2015 环境管理体系认证将到期，ISO 14001:2015 环境管理体系认证由第三方认证机构 DNV. GL 首次审核通过后发放证书，证书有效期三年。和舰芯片每年皆须委托第三方认证机构 DNV. GL 进行外部审核，审核通过后才能继续使用证书，和舰芯片自首次通过认证后每年都通过了 DNV. GL 的外部审核。该证书有效期为三年，目前发行人已委托 DNV. GL 在 2019 年 8 月份到和舰芯片进行换证外部审核，预计 2019 年 9 月份可取得新的质量管理体系认证证书，不存在到期续期不能的风险。

本所律师经核查认为，发行人的所有客户未直接向发行人及其子公司授予相关认证或准入。目前发行人已取得诸多第三方机构通过的质量管理体系认证证书，已满足发行人向所有客户销售的现有产品的需求。和舰芯片将在证书到期前通过

相关审核并取得新的认证证书，不存在相关认证证书到期不能续期的风险。

本补充法律意见书正本两份，副本两份。

以下无正文。

（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于和舰芯片制造（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（二）》签字、盖章页）

北京海润天睿律师事务所（盖章）

经办律师（签字）：

负责人（签字）：

李冬梅：

罗会远：

井泉：

2019年5月24日

